

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-63154

(P2012-63154A)

(43) 公開日 平成24年3月29日(2012.3.29)

(51) Int.Cl.

G01N 21/65 (2006.01)  
G01N 21/64 (2006.01)

F 1

G01N 21/65  
G01N 21/64

テーマコード(参考)

2 G043 G

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 32 頁)

(21) 出願番号  
(22) 出願日特願2010-205509 (P2010-205509)  
平成22年9月14日 (2010.9.14)

(71) 出願人 000002369  
セイコーエプソン株式会社  
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
(74) 代理人 100090479  
弁理士 井上 一  
(74) 代理人 100104710  
弁理士 竹脇 昇  
(74) 代理人 100124682  
弁理士 黒田 泰  
(72) 発明者 坂上 裕介  
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
(72) 発明者 尼子 淳  
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

最終頁に続く

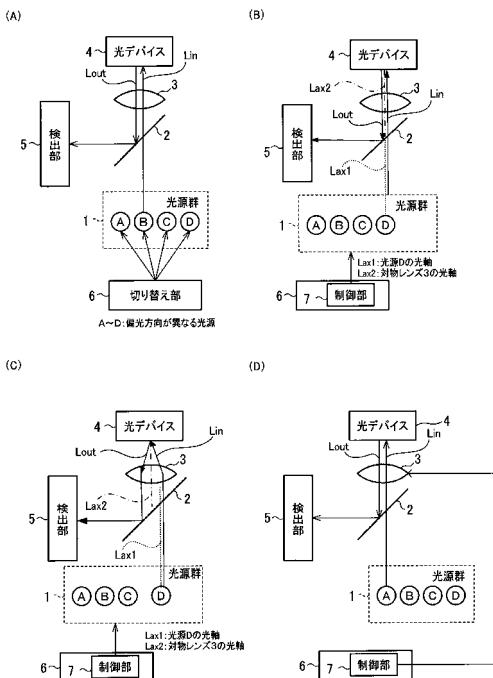
(54) 【発明の名称】検出装置

## (57) 【要約】

【課題】 より適切な増強電場を提供可能な検出装置等を提供する。

【解決手段】 検出装置は、複数の光源A～Dを有する第1の光源群1と、複数の光源A～Dを切り替え、複数の光源A～Dのいずれか1つを有効にさせる切り替え部6と、切り替え部6により有効になった光源Bからの光を光デバイス4の電気伝導体に入射させる第1の光学系2, 3と、電気伝導体により散乱または反射された光の中からラマン散乱光を検出する検出器5とを含む。第1の光源群の複数の光源A～Dの各々は、有効な状態で、互いに異なる偏光方向を有する光を放射可能である。

【選択図】 図1



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

複数の光源を有する第1の光源群と、  
前記複数の光源を切り替え、前記複数の光源のいずれか1つを有効にさせる切り替え部と、

前記切り替え部により有効になった光源からの光を光デバイスの電気伝導体に入射させる第1の光学系と、

前記電気伝導体により散乱または反射された光の中からラマン散乱光を検出する検出器とを含み、

前記第1の光源群の前記複数の光源の各々は、有効な状態で、互いに異なる偏光方向を有する光を放射可能であることを特徴とする検出装置。 10

**【請求項 2】**

請求項1において、

前記切り替え部が前記第1の光源群の前記複数の光源の中から第1の光源を有効にさせ、且つ前記検出部が所与の強度以下で前記ラマン散乱光を検出する場合、前記切り替え部は、前記第1の光源を無効にさせ、前記第1の光源群の前記複数の光源の中から第2の光源を有効にさせることを特徴とする検出装置。

**【請求項 3】**

請求項1又は2において、

前記切り替え部は、前記光デバイスと前記切り替え部により有効になった前記光源との相対位置を可変制御する制御部を有することを特徴とする検出装置。 20

**【請求項 4】**

請求項1又は2において、

前記切り替え部は、前記光デバイスと前記第1の光学系との相対位置を可変制御する制御部を有することを特徴とする検出装置。

**【請求項 5】**

請求項3又は4において、

前記制御部は、前記切り替え部により有効になった前記光源の光軸を前記第1光学系の光軸と一致させることを特徴とする検出装置。

**【請求項 6】**

請求項3又は4において、

前記制御部は、前記切り替え部により有効になった前記光源の光軸を前記第1光学系の光軸からずらすことを特徴とする検出装置。 30

**【請求項 7】**

請求項2において、

複数の光源を有する第2の光源群をさらに含み、

前記第2の光源群の前記複数の光源の各々は、前記第1の光源群の前記複数の光源のいずれか1つに対応し、

前記第2の光源群の前記複数の光源の各々は、有効な状態で、前記第1の光源群の前記複数の光源のうちの対応する1つの光源の偏光方向と等しい偏光方向を有する光を放射可能であり、 40

前記切り替え部が前記第1の光源群の前記複数の光源の中から前記第2の光源を有効にさせ、且つ前記検出部が前記所与の強度以下で前記ラマン散乱光を検出する場合、前記切り替え部は、前記第2の光源を有効に保ち、前記第2の光源群の前記複数の光源の中から第3の光源を有効にさせ、

前記電気伝導体に向かう前記第2の光源からの光が有する偏光方向は、前記電気伝導体に向かう前記第3の光源からの光が有する偏光方向と等しいことを特徴とする検出装置。

**【請求項 8】**

請求項1乃至7のいずれかにおいて、

前記光デバイスの前記電気伝導体は、複数の突起を有する第1の突起群を有し、 50

前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記電気伝導体の仮想平面に対して平行な方向に沿って、第1の周期で配列され、

前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光が有する偏光方向の前記仮想平面に平行な成分と前記第1の突起群の配列方向とが平行になるように、前記第1の光学系は、前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光を前記第1の突起群に入射させることを特徴とする検出装置。

#### 【請求項9】

請求項8において、

前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記第1の突起群の頂面で、電気伝導体により形成される第2の突起群を有し、

前記第1の突起群の前記複数の突起のいずれか1つに対応する前記第2の突起群の複数の突起の各々は、前記仮想平面に平行な前記方向に沿って、前記第1の周期よりも短い第2の周期で配列されることを特徴とする検出装置。

#### 【請求項10】

請求項8又は9において、

前記第1の突起群が配列される面であって前記第1の突起群の隣り合う突起間の面に、電気伝導体により形成される第3の突起群を有し、

前記第3の突起群の複数の突起の各々は、前記第1の突起群の前記隣り合う突起間で、前記仮想平面に平行な前記方向に沿って、前記第1の周期よりも短い第3の周期で配列されることを特徴とする検出装置。

#### 【請求項11】

請求項6において、

前記光デバイスの前記電気伝導体は、複数の突起を有する第1の突起群を有し、

前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記電気伝導体の仮想平面に対して平行な方向に沿って、第1の周期で配列され、

前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光の進行方向を前記仮想平面に向かう垂線に対して傾斜させた場合の表面プラズモン共鳴が、第1の共鳴ピーク波長と第2の共鳴ピーク波長の各々で生じ、

前記第1の共鳴ピーク波長を有する第1の共鳴ピーク波長帯域は、

前記表面プラズモン共鳴に起因する表面増強ラマン散乱における励起波長を有し、

前記第2の共鳴ピーク波長を有する第2の共鳴ピーク波長帯域は、

前記表面増強ラマン散乱におけるラマン散乱波長を有することを特徴とする検出装置。

#### 【請求項12】

請求項1乃至11のいずれかにおいて、

前記ラマン散乱光を前記検出器に導く第2の光学系をさらに含み、

前記検出器は、前記第2の光学系を介して前記ラマン散乱光を受光することを特徴とする検出装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【技術分野】

##### 【0001】

本発明は、検出装置等に関する。

##### 【背景技術】

##### 【0002】

ラマン分光装置は、一般に、検出対象である物質に依存するラマン散乱光を検出してラマンスペクトルを得る検出器を含み、ラマンスペクトルによる分光分析を行い、検出対象である物質を特定することができる。しかしながら、ラマン散乱光の信号強度は、一般に、微弱であり、検出感度が低かった。

##### 【0003】

特許文献1は、ハンドヘルドラマン体液分析器を開示し、金ゾルゲル・ストリップで表面増強ラマン散乱を提供し、ラマン散乱光の信号強度を高めている。

**【0004】**

なお、励起光を例えれば金属表面に照射することで局在プラズモンを生じさせることができ、励起光と局在プラズモンとの結合で局所的に電場を増強することができる。表面増強ラマン散乱では、ラマン散乱光は、増強電場によって増強されると考えられている。

**【0005】**

特許文献2は、安定した偏光面制御が可能な垂直共振器面発光レーザー(VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting Laser)を開示し、このような垂直共振器面発光レーザー等で励起光を提供することができる。

**【0006】**

励起光と局在プラズモンとの結合の際に、局在プラズモン共鳴による光吸収が起こり、例えば、特許文献3には、表面に金属微粒子が固定された基板による局在表面プラズモン共鳴を利用して、センサー感度を向上する手法が開示されている。特許文献4には、長波長側にシフトする共鳴ピークと短波長側にシフトする共鳴ピークをもつ局在プラズモン共鳴センサーの技術が開示されている。また、特許文献5には、複数の波長に対して共振可能とするために複数の共振領域により微小共振器が構成された電場増強デバイスの技術が開示されている。

10

**【先行技術文献】****【特許文献】****【0007】**

**【特許文献1】**特表2008-529006号公報

20

**【特許文献2】**特許第3482824号公報

**【特許文献3】**特開2000-356587号公報

**【特許文献4】**特開2007-10648号公報

**【特許文献5】**特開2009-250951号公報

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0008】**

ラマン分光装置は、一般に、検出対象である物質が吸着可能な金属ナノ構造等の電気伝導体を有する光デバイスを含み、電気伝導体に光を入射させることで増強電場に起因するラマン散乱光を検出できる。光デバイスの種類や製造誤差によっては、増強電場の増強度が低く、ラマン散乱光の信号強度は、規定値に達しないこともある。

30

**【0009】**

本発明の幾つかの態様によれば、より適切な増強電場を提供可能な検出装置等を提供できる。

**【課題を解決するための手段】****【0010】**

本発明の一態様は、複数の光源を有する第1の光源群と、

前記複数の光源を切り替え、前記複数の光源のいずれか1つを有効にさせる切り替え部と、

前記切り替え部により有効になった光源からの光を光デバイスの電気伝導体に入射させる第1の光学系と、

前記電気伝導体により散乱または反射された光の中からラマン散乱光を検出する検出器とを含み、

前記第1の光源群の前記複数の光源の各々は、有効な状態で、互いに異なる偏光方向を有する光を放射可能であることを特徴とする検出装置に関係する。

40

**【0011】**

本発明の一態様によれば、切り替え部により第1の光源群の複数の光源を切り替えることができ、従って、偏光方向を切り替えることができる。例えば蒸着による金属微粒子で金属ナノ構造を光デバイスに形成した場合、蒸着によって形成される独立したアイランド状の金属ナノ構造は、金属微粒子の大きさや形が均一ではなく、増強電場が形成される間

50

隙も均一にならない。言い換えれば、光デバイスに入射する光の偏光方向によっては、増強電場が強くなったり弱くなったりする。また、例えばフォトリソグラフィー法で金属ナノ構造を光デバイスに形成した場合、特定の方向に平行な光の偏光方向を設定することでき、理想的な増強電場を提供できる。言い換えれば、光デバイスに入射する光の偏光方向を正確に設定しなくては、増強電場が強くなったり弱くなったりする。このように、蒸着やフォトリソグラフィー法による金属ナノ構造を有する光デバイスでは、増強電場に起因するラマン散乱光の信号強度は、光デバイスに入射する光の偏光方向に依存する。そこで、光デバイスに入射する光の偏光方向を切り替えることでより適切な増強電場を提供することができる。

【0012】

また、本発明の一態様では、前記切り替え部が前記第1の光源群の前記複数の光源の中から第1の光源を有效地にさせ、且つ前記検出部が所与の強度以下で前記ラマン散乱光を検出する場合、前記切り替え部は、前記第1の光源を無効にさせ、前記第1の光源群の前記複数の光源の中から第2の光源を有效地にさせてよい。

【0013】

このようにすれば、第1の光源によるラマン散乱光を実際に検出する時、第1の光源によるラマン散乱光の信号強度が低い場合、第1の光源から第2の光源に切り替えて、第2の光源によるラマン散乱光を検出することができる。

【0014】

また、本発明の一態様では、前記切り替え部は、前記光デバイスと前記切り替え部により有効になった前記光源との相対位置を可変制御する制御部を有してもよい。

【0015】

このようにすれば、複数の光源のいずれか1つを有效地にさせる時に、例えば光源の位置を変化させることができる。

【0016】

また、本発明の一態様では、前記切り替え部は、前記光デバイスと前記第1の光学系との相対位置を可変制御する制御部を有してもよい。

【0017】

このようにすれば、複数の光源のいずれか1つを有效地にさせる時に、例えば第1の光学系の位置を変化させることができる。

【0018】

また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記切り替え部により有効になった前記光源の光軸を前記第1光学系の光軸と一致させてよい。

【0019】

このようにすれば、複数の光源のいずれか1つを有效地にさせる時に、有効になった光源の光軸を第1光学系の光軸と一致させた状態で、有効になった光源からの光を光デバイスに入射させることができる。

【0020】

また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記切り替え部により有効になった前記光源の光軸を前記第1光学系の光軸からはずらしてもよい。

【0021】

このようにすれば、複数の光源のいずれか1つを有效地にさせる時に、有効になった光源の光軸を第1光学系の光軸からはずした状態で、有効になった光源からの光を光デバイスに入射させることができる。

【0022】

また、本発明の一態様では、検出装置は、複数の光源を有する第2の光源群をさらに含んでもよく、前記第2の光源群の前記複数の光源の各々は、前記第1の光源群の前記複数の光源のいずれか1つに対応してもよく、

前記第2の光源群の前記複数の光源の各々は、有効な状態で、前記第1の光源群の前記

10

20

30

40

50

複数の光源のうちの対応する1つの光源の偏光方向と等しい偏光方向を有する光を放射可能であってもよく、

前記切り替え部が前記第1の光源群の前記複数の光源の中から前記第2の光源を有効にさせ、且つ前記検出部が前記所与の強度以下で前記ラマン散乱光を検出する場合、前記切り替え部は、前記第2の光源を有効に保ち、前記第2の光源群の前記複数の光源の中から第3の光源を有効にさせててもよく、

前記電気伝導体に向かう前記第2の光源からの光が有する偏光方向は、前記電気伝導体に向かう前記第3の光源からの光が有する偏光方向と等しくてもよい。

#### 【0023】

このようにすれば、第2の光源によるラマン散乱光を実際に検出する時、第2の光源によるラマン散乱光の信号強度が低い場合、第2の光源及び第3の光源を有効にさせて、偏光方向が等しい2つの光源によるラマン散乱光を検出することができる。 10

#### 【0024】

また、本発明の一態様では、前記光デバイスの前記電気伝導体は、複数の突起を有する第1の突起群を有してもよく、

前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記電気伝導体の仮想平面に対して平行な方向に沿って、第1の周期で配列されてもよく、

前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光が有する偏光方向の前記仮想平面に平行な成分と前記第1の突起群の配列方向とが平行になるように、前記第1の光学系は、前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光を前記第1の突起群に入射させてもよい。 20

#### 【0025】

このようにすれば、光デバイスにおける増強電場を第1の突起群で高めることができる。また、偏光方向の仮想平面に平行な成分が第1の突起群の配列方向と平行である直線偏光を光デバイスに入射できる。これにより、伝搬型の表面プラズモンを励起できる。

#### 【0026】

また、本発明の一態様では、前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記第1の突起群の頂面で、電気伝導体により形成される第2の突起群を有してもよく、

前記第1の突起群の前記複数の突起のいずれか1つに対応する前記第2の突起群の複数の突起の各々は、前記仮想平面に平行な前記方向に沿って、前記第1の周期よりも短い第2の周期で配列されてもよい。 30

#### 【0027】

このようにすれば、光デバイスにおける増強電場を第2の突起群でも高めることができる。

#### 【0028】

また、本発明の一態様では、前記第1の突起群が配列される面であって前記第1の突起群の隣り合う突起間の面に、電気伝導体により形成される第3の突起群を有してもよく、

前記第3の突起群の複数の突起の各々は、前記第1の突起群の前記隣り合う突起間で、前記仮想平面に平行な前記方向に沿って、前記第1の周期よりも短い第3の周期で配列されてもよい。 40

#### 【0029】

このようにすれば、光デバイスにおける増強電場を第3の突起群でも高めることができる。

#### 【0030】

また、本発明の一態様では、前記光デバイスの前記電気伝導体は、複数の突起を有する第1の突起群を有してもよく、

前記第1の突起群の前記複数の突起の各々は、前記電気伝導体の仮想平面に対して平行な方向に沿って、第1の周期で配列されてもよく、

前記切り替え部により有効になった前記光源からの前記光の進行方向を前記仮想平面に向かう垂線に対して傾斜させた場合の表面プラズモン共鳴が、第1の共鳴ピーク波長と第 50

2の共鳴ピーク波長の各々で生じてもよく、

前記第1の共鳴ピーク波長を有する第1の共鳴ピーク波長帯域は、

前記表面プラズモン共鳴に起因する表面増強ラマン散乱における励起波長を有してもよく、

前記第2の共鳴ピーク波長を有する第2の共鳴ピーク波長帯域は、

前記表面増強ラマン散乱におけるラマン散乱波長を有してもよい。

### 【0031】

このようにすれば、第1の突起群の電気伝導体の突起が、仮想平面に対して平行な方向に沿って第1の周期で配列される。この第1の周期で配列された第1の突起群には、仮想平面に向かう垂線に対して傾斜した方向に進行する光が入射される。この入射された光により、第1の共鳴ピーク波長と第2の共鳴ピーク波長の各々で表面プラズモン共鳴が生じる。このとき、第1の共鳴ピーク波長を含む第1の共鳴ピーク波長帯域には、表面増強ラマン散乱における励起波長が含まれ、第2の共鳴ピーク波長を含む第2の共鳴ピーク波長帯域には、表面増強ラマン散乱におけるラマン散乱波長が含まれるように、第1の周期と光の入射角度が設定される。これにより、励起波長における電場増強度とラマン散乱波長における電場増強度を向上すること等が可能になる。

### 【0032】

また、本発明の一態様では、検出装置は、

前記ラマン散乱光を前記検出器に導く第2の光学系をさらに含んでもよく、

前記検出器は、前記第2の光学系を介して前記ラマン散乱光を受光してもよい。

### 【0033】

このようにすれば、第2の光学系でラマン散乱光を効率良く受けることができる。

### 【図面の簡単な説明】

### 【0034】

【図1】図1(A)、図1(B)、図1(C)、図1(D)は、本実施形態の検出装置の構成例。

【図2】図2(A)、図2(B)、図2(C)、図2(D)は、ラマン散乱光の検出原理の説明図。

### 【図3】本実施形態の検出装置の具体的な構成例。

### 【図4】図3の検出装置のブロック図の1例。

### 【図5】垂直共振器面発光レーザーの構造例。

### 【図6】図6(A)、図6(B)、図6(C)、図6(D)は、複数の光源の配置例。

### 【図7】光源の特性の説明図。

【図8】図8(A)、図8(B)、図8(C)、図8(D)、図8(E)は、フォトリソグラフィー法の概要説明図。

【図9】図9(A)、図9(B)、図9(C)、図9(D)、図9(E)は、金属ナノ構造の製造プロセスの概要説明図。

【図10】図10(A)、図10(B)は、金属ナノ構造で形成される増強電場の概要説明図。

### 【図11】2つの共鳴ピークの概要説明図。

### 【図12】センサーチップの構成例の斜視図。

### 【図13】図12のセンサーチップの断面図。

### 【図14】センサーチップの反射光強度の特性例。

### 【図15】表面プラズモンポラリトンの励起条件の説明図。

### 【図16】センサーチップの反射光強度の他の特性例。

### 【図17】図12のセンサーチップの変形例の斜視図。

### 【図18】図17のセンサーチップの断面図。

【図19】図19(A)、図19(B)は、センサーチップに入射光を傾斜させて入射させるための手法の説明図。

### 【図20】図20(A)、図20(B)は、電気伝導体の製造方法の概要説明図。

10

20

30

40

50

【図21】図21(A)、図21(B)、図21(C)は、ラマンスペクトルのピーク抽出の概要説明図。

【発明を実施するための形態】

【0035】

以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお以下に説明する本実施形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。

【0036】

1. 概要

1.1. 基本構成

図1(A)、図1(B)、図1(C)、図1(D)は、本実施形態の検出装置の構成例を示す。図1(A)に示すように、検出装置は、光源群1と、切り替え部6と、光学系と、検出器5とを含む。光学系(第1の光学系)は、例えばハーフミラー2及び対物レンズ3で構成される。光源群1(第1の光源群)は、複数の光源A～Dを有する。複数の光源A～Dの各々は、有効な状態で、互いに異なる偏光方向を有する光を放射可能である。光源群1は、図1(A)の例に限定されず、2つの光源を有してもよく、3つの光源を有してもよく、5つ以上の光源を有してもよい。なお、光源は、指向性を有することができ、光源は、高い指向性を有する光源(例えば、レーザー)で構成することが好ましい。

【0037】

切り替え部6は、複数の光源A～Dを切り替え、複数の光源A～Dのいずれか1つを有效地にさせる。具体的には、切り替え部6は、例えば光源Bの電源だけをONに設定し、残りの光源A、C及びDの電源をOFFに設定し、複数の光源A～Dの中から例えば光源Bを有效地にさせる。ハーフミラー2及び対物レンズ3(広義には光学系)は、切り替え部6により有効になった例えば光源Bからの光を光デバイス4の電気伝導体に入射させる。検出器5は、電気伝導体により散乱または反射された光の中からラマン散乱光を検出する。検出装置は、ラマン検出装置と呼ぶこともでき、ラマンスペクトルによる分光分析をさらに行う検出装置は、ラマン分光装置と呼ぶこともできる。

【0038】

本発明者らは、ラマン分光装置等で利用される光デバイス4の電気伝導体近傍における増強電場に起因するラマン散乱光の信号強度が、光デバイスに入射する光の偏光方向に依存することを認識した。そこで、切り替え部6により複数の光源A～Dを切り替えることができ、従って、光デバイスに入射する光の偏光方向を切り替えることでより適切な増強電場を提供することができる。なお、ラマン散乱光及び増強電場については、後述する。

【0039】

図1(A)の例では、光源Bが有效地にされているが、光源Bが有效地にされる前に、例えば光源Aが有效地にされていてもよい。即ち、切り替え部6は、光源A(第1の光源)を光源B(第2の光源)に切り替えてよい。具体的には、切り替え部6が複数の光源A～Dの中から光源A(切り替え前の光源)を有效地にさせ、且つ検出部5が所与の強度以下でラマン散乱光を検出する場合、切り替え部6は、光源Aを無効にさせ、複数の光源A～Dの中から光源B(切り替え後の光源)を有效地にさせることができる。複数の光源A～Dの切り替えは、所与の順番で行うことができ、例えば、光源Aの優先度は、光源Bの優先度よりも高く設定することができる。

【0040】

光源Bを有效地にさせ、且つ検出部5が所与の強度以下でラマン散乱光を検出する場合、切り替え部6は、光源Bを無効にさせ、光源Cを有效地にさせることができる。この場合、例えば光源Bの優先度は、光源Cの優先度よりも高い。また、光源Cを有效地にさせ、且つ検出部5が所与の強度以下でラマン散乱光を検出する場合、切り替え部6は、光源Cを無効にさせ、光源Dを有效地にさせることができる。この場合、例えば光源Cの優先度は、光源Dの優先度よりも高い。

【0041】

10

20

30

40

50

なお、図1(A)の例では、光源Dからの光L<sub>in</sub>(入射光)の光路及び光デバイス4からの光L<sub>out</sub>(散乱光、反射光)の光路は、実際の光路を正確に表すものではない。言い換れば、光源Dからの光L<sub>in</sub>(入射光)の光路の存在及び光デバイス4からの光L<sub>out</sub>(散乱光、反射光)の光路の存在を単に示すものである。

#### 【0042】

図1(B)の例では、切り替え部6は、光デバイス4と切り替え部6により有効になった例えは光源Dとの相対位置を可変制御する制御部7を有することができる。なお、切り替え部6は、図1(B)で示されるような制御部7を有しないで、複数の光源A～Dのいずれか1つを有効にさせててもよい。切り替え部6が制御部7を有する場合、具体的には、制御部7は、少なくとも有効になった例えは光源Dの位置を変化させることができ、複数の光源A～Dを有する光源群1全体の位置を変化させてもよい。なお、制御部7は、例えはXYステージ等の作動部を有してもよく、作動部への信号だけを送信してもよい。

10

#### 【0043】

図1(B)の例では、複数の光源A～Dの切り替えに伴い、光源Dを有効にさせる時に、制御部7は、例えは光源Dの位置を変化させることができる。なお、制御部7は、光デバイス4の位置を変化させてもよい。図1(B)の例では、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>を対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>(広義には光学系の光軸)を一致させるように、制御部7は、光源Dの位置を変化させる。

20

#### 【0044】

この場合、実際には、光源Dからの光L<sub>in</sub>は、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>及び対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>と重なることが予想されるが、図1(B)の例では、光源Dからの光L<sub>in</sub>が光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>及び対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>と重ならないように示されている。図1(B)の例では、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>と対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>とが一致することが理解できる目的で、光源Dからの光L<sub>in</sub>は、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>及び対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>と重ならないように図示されている。

20

#### 【0045】

図1(C)の例では、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>を対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>からはずらすように、制御部7は、光源Dの位置を変化させる。この場合、実際には、光源Dからの光L<sub>in</sub>が、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>と重なることが予想されるが、図1(C)の例では、光源Dからの光L<sub>in</sub>が光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>と重ならないように示されている。図1(C)の例では、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>と対物レンズ3の光軸L<sub>ax2</sub>とが一致しないことが理解できる目的で、光源Dからの光L<sub>in</sub>は、光源Dの光軸L<sub>ax1</sub>と重ならないように図示されている。

30

#### 【0046】

図1(D)の例では、切り替え部6は、光デバイス4と光学系との相対位置を可変制御する制御部7を有することができる。具体的には、複数の光源A～Dの切り替えに伴い、例えは光源Aを有効にさせる時に、制御部7は、例えは対物レンズ3の位置を変化させることができる。対物レンズ3の位置を変化させることにより、有効になった例えは光源Aの光軸を対物レンズ3の光軸と一致させることができるが、光源Aの光軸を対物レンズの光軸からはずらしてもよい。

40

#### 【0047】

##### 1.2. 検出原理

図2(A)、図2(B)、図2(C)、図2(D)は、ラマン散乱光の検出原理の説明図を示す。図2(A)の例では、ラマン分光について説明され、標的分子(広義には標的物)に入射光(振動数 $\nu$ )が照射されると、一般に、入射光の多くは、レイリー散乱光として散乱され、レイリー散乱光の振動数又は波長は変化しない。入射光の一部は、ラマン散乱光として散乱され、ラマン散乱光の振動数( $\nu - \nu'$ 及び $\nu + \nu'$ )又は波長は、標的分子の振動数 $\nu'$ (分子振動)が反映される。入射光の一部は、標的分子を振動させてエネルギーを失うが、標的分子の振動エネルギーがラマン散乱光の振動エネルギー又は光エネルギーに付加されることもある。このような振動数のシフト( $\nu'$ )をラマンシフ

50

トと呼ぶ。

#### 【0048】

図2(B)の例では、標的分子が例えばアセトアルデヒド分子である場合のラマンスペクトルが示されている。言い換えれば、図2(B)に示すラマンスペクトルを分析することで、例えばアセトアルデヒド分子を特定することができる。しかしながら、標的分子が微量である場合、ラマン散乱光は、一般に微弱であり、標的分子を検出又は特定することは困難である。そこで、増強電場を提供し、ラマン散乱光を増強電場によって増強することが好ましい。なお、図2(B)のラマンスペクトルは、ラマンシフトを波数で表している。

#### 【0049】

図2(C)の例では、金属微粒子20に入射光(照射光)を照射した時に形成される増強電場について説明される。入射光の波長よりも小さな金属微粒子20(金属ナノ粒子)に対して入射光を照射する場合、入射光の電場は、金属微粒子20の表面に存在する自由電子に作用し、共鳴を引き起こす。これにより、自由電子による電気双極子が金属微粒子20内に励起され、金属微粒子20の近傍に入射光の電場よりも強い増強電場が形成される。この現象は、入射光の波長よりも小さな金属微粒子20等の電気伝導体に特有の現象である。

#### 【0050】

図2(D)の例では、光デバイス4に入射光を照射した時に表面増強ラマン散乱(SERS: Surface Enhanced Raman Scattering)について説明される。光デバイス4は、例えば基板100を有し、基板100の凸部105に金属微粒子20を形成することで、複数の突起110を有する突起群115(広義には金属ナノ構造)を提供することができる。このような光デバイスに入射光を照射することで、突起群115の隣り合う突起110(凸部105に形成される電気伝導体)間に増強電場を形成することができる。増強電場に標的分子が入り込むと、その標的分子によるラマン散乱光は増強電場で増強されて、ラマン散乱光の信号強度は、強くなる。このような表面増強ラマン散乱では、標的分子が微量であっても、検出感度を高めることができる。

#### 【0051】

なお、図1(A)～図1(D)で示される光デバイス4は、図2(D)に示されるような金属ナノ構造を有することが好ましいが、図2(C)に示されるような増強電場を提供しなくてもよい。

#### 【0052】

##### 2. 具体例

###### 2.1. 全体構成

図3は、本実施形態の検出装置の具体的な構成例を示す。以下では、図1等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。図3に示される検出装置は、センサーチップ300(広義には光デバイス4)及び誘導部420(搬送部)を含む。標的物は、吸引口400(搬入口)から誘導部420の内部に導入され、排出口410から誘導部420の外部に排出される。図3の例では、検出装置は、ファン450(広義には吸引部)を排出口410付近に有し、ファン450を作動させると、誘導部420の吸引流路421、センサーチップ300付近の流路422及び排出流路423内の圧力(気圧)が低下する。これにより、標的物(気体試料)が誘導部420に吸引される。標的物は、吸引流路421を通り、センサーチップ300付近の流路422を経由して排出流路423から排出される。このとき、標的物の一部が、センサーチップ300の表面(電気伝導体)に付着する。

#### 【0053】

標的物は、例えば麻薬やアルコールや残留農薬等の希薄な分子や、ウイルス等の病原体等を想定することができる。

#### 【0054】

図3の例では、検出装置は、カバー440を有し、カバー440は、センサーチップ3

10

20

30

40

50

00等を格納することができる。また、検出装置は、筐体500を有し、筐体500内に例えば光源群1、ハーフミラー2、対物レンズ3及び検出器5を含み、検出器5は、例えば分光素子370及び受光素子380を有する。分光素子370は、例えばエタロンで構成することができる。さらに、検出装置は、集光レンズ360、光フィルター365、処理部460、電力供給部470、通信接続口510及び電源接続口520を含むことができる。

#### 【0055】

図3の例では、光源群1は、例えば3つの光源A～Cを有し、例えば3つのコリメーターレンズ320及び例えば3つの偏光制御素子330をさらに有する。なお、3つのコリメーターレンズ320の各々は、3つの光源A～Cのいずれか1つに対応している。また、3つの偏光制御素子330の各々も、3つの光源A～Cのいずれか1つに対応している。3つの光源A～Cのいずれか1つから出射された光は、コリメーターレンズ320により平行光にされ、偏光制御素子330により直線偏光にされる。なお、光源として例えば面発光レーザーを採用し、直線偏光を有する光を発光可能であれば、偏光制御素子330を省略することができる。

10

#### 【0056】

3つの光源A～Cのいずれか1つからの光は、ハーフミラー2(ダイクロイックミラー)によりセンサーチップ300の方向に導かれ、対物レンズ3で集光され、センサーチップ300に入射する。センサーチップ300の表面には、例えば金属ナノ構造が形成される。センサーチップ300から例えば表面増強ラマン散乱によるレイリー散乱光及びラマン散乱光が放射される。センサーチップ300からのレイリー散乱光及びラマン散乱光は、対物レンズ3を通過し、ハーフミラー2によって検出器5の方向に導かれる。

20

#### 【0057】

図3の例では、センサーチップ300からのレイリー散乱光及びラマン散乱光は、集光レンズ360で集光され、光フィルター365に到達する。そして、光フィルター365(例えばノッチフィルター)によりラマン散乱光が取り出され、受光素子380は、そのラマン散乱光を分光素子370を介して受光する。分光素子370を通過する光の波長は、処理部460により制御(選択)することができる。

20

#### 【0058】

受光素子380は、光学系及び分光素子370を介してラマン散乱光を受光する。光学系(第2の光学系)は、例えばハーフミラー2、集光レンズ360及び光フィルター365で構成される。分光素子370及び受光素子380によって、標的物に特有のラマンスペクトルが得られ、得られたラマンスペクトルと予め保持するデータと照合することで、標的物を特定することができる。

30

#### 【0059】

図3の例では、処理部460は、例えば図1(A)等に示される切り替え部6の機能を実行することができ、処理部460は、3つの光源A～Cのいずれか1つを有効にさせることができ。処理部460は、例えば図1(B)等に示される制御部7の機能を実行することができ、処理部460は、例えば光源Dの位置を可変制御することができる。また、処理部460は、図3に示される光源群1以外の検出器5、ファン450等への命令を送ることができ、処理部460は、光源群1だけでなく、検出器5、ファン450等も制御することができる。さらに、処理部460は、ラマンスペクトルによる分光分析を実行することができ、処理部460は、標的物を特定することができる。なお、処理部460は、ラマン散乱光による検出結果、ラマンスペクトルによる分光分析結果等を例えば通信接続口510に接続される外部機器(図示せず)に送信することができる。

40

#### 【0060】

図3の例では、電力供給部470は、図3に示される処理部460、光源群1、検出器5、ファン450等への電力を供給することができる。電力供給部470は、例えば2次電池で構成することができ、1次電池、ACアダプター等で構成してもよい。電力供給部470が2次電池で構成される場合、例えば電源接続口520に接続される充電器(図示

50

せず)は、2次電池を充電することができる。電力供給部470がACアダプターで構成される場合、ACアダプターは、検出装置の外部に配置され、電源接続口520に接続される。なお、検出装置は、例えば表示部(図4の例では表示部540)を含むことができ、表示部は、電力供給部470の状態(例えば電池切れ、充電中、充電完了、電力供給中等)を表示することができる。

#### 【0061】

図4は、図3の検出装置のブロック図の1例を示す。以下では、図3等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。図4に示されるように、検出装置は、例えば表示部540、操作部550及びインターフェース530をさらに含むことができる。また、図3に示される処理部460は、例えばCPU(Central Processing Unit)461、RAM(Random Access Memory)462、ROM(Read Only Memory)463を有することができる。さらに、検出装置は、例えば、光源ドライバー15、分光ドライバー375、受光回路385及びファンドライバー455を含むことができる。以下に、図4に示す検出装置の動作例を説明する。

10

#### 【0062】

図4の例では、CPU461は、ラマン散乱光を検出する準備が完了したか否かを判断することができ、CPU461は、その準備が完了したことを表す信号を表示部540に送ることができる。また、CPU461は、その信号以外の信号も表示部540に送ることができ、表示部540は、CPU461からの信号(表示信号)に応じて、様々な表示をユーザーに提供することができる。

20

#### 【0063】

表示部540がラマン散乱光を検出する準備が完了したことを示す場合、ユーザーは、操作部550を操作して、ラマン散乱光の検出を開始することができる。操作部550からの信号(操作信号)が検出の開始を表す場合、CPU461は、光源ドライバー15を介して光源群1を起動することができる。具体的には、光源ドライバー15(広義にはCPU461)は、所与の順番に従い、光源群1の少なくとも1つの光源の電源をONさせることができる。例えば、図3の光源Aだけの電源をONさせることができる。なお、光源群1は、少なくとも1つの光源だけでなく、温度センサー(図示せず)及び光量センサー(図示せず)を有することができ、光源群1は、例えば光源Aの温度及び光量を光源ドライバー15を介してCPU461に送ることができる。CPU461は、例えば光源Aの温度及び光量を受け、光源Aの出力が安定しているか否かを判断することができる。例えば光源Aの電源がONされた状態で、場合によっては光源Aの出力が安定した後に、CPU461は、ファンドライバー455を介してファン450を起動することができる。

30

#### 【0064】

なお、CPU461(広義には処理部460)は、例えば図1(A)等に示される切り替え部6の機能を実行することができ、CPU461は、例えば光源ドライバー15を介して、光源群1の複数の光源を所与の順番で切り替えることができる。また、CPU461は、例えば図1(B)等に示される制御部7の機能を実行することができ、CPU461は、例えば光源ドライバー15を介して、光源群1の複数の光源のうちの例えば有効になった光源の位置を可変制御することができる。代替的に、CPU461は、例えば光源ドライバー15又はレンズドライバー(図示せず)を介して、例えば図1(D)等に示される対物レンズ3の位置を可変制御してもよい。

40

#### 【0065】

図4の例では、ファンドライバー455は、ファン450の電源をONさせることができ、これにより、標的物(気体試料)が図3の誘導部420に吸引される。例えば、図3の光源Aの電源がONされる場合、例えば光源Aから光がハーフミラー2を介して図3のセンサーチップ300に到達している。これに応じて、センサーチップ300からレイリー散乱光及びラマン散乱光がハーフミラー2に戻ってくる。センサーチップ300からレイリー散乱光及びラマン散乱光は、集光レンズ360を介して光フィルター365に到達する。光フィルター365は、レイリー散乱光を遮断する一方、ラマン散乱光を分光素子

50

370に導く。以上は、吸引口400(搬入口)から誘導部420、排出口410までの流路抵抗が比較的小さい場合ファン450によって可能であるが、流路抵抗が比較的大きい場合には、ファン450に代って吸引ポンプ(図示せず)などを使用することができる。

#### 【0066】

図4の例では、分光ドライバー375(広義にはCPU461)は、分光素子370を制御することができます。分光素子370は、例えば共振波長を可変できる可変エタロン分光器で構成することができる。分光素子370がファブリペロー共振を利用したエタロンである場合、分光ドライバー375は、互いに対向する2枚のエタロン板の距離を調整しながら、エタロンを通過する光の波長を変化(選択)することができる。具体的には、エタロンを通過する光の波長を第1の波長から第Nの波長までの範囲に設定する場合、まずは、第1の波長を有する光が最大強度を示すように2枚のエタロン板の距離を設定する。その後、第1の波長から半値幅だけずらした第2の波長を有する光が最大強度を示すように2枚のエタロン板の距離を再度設定する。このような手法で第1の波長、第2の波長、第3の波長、・・・、第Nの波長を順次選択しながら、エタロンを通過する光を受光素子380で受光する。

#### 【0067】

図4の例では、受光回路385(広義にはCPU461)は、受光素子380で受けた光を電気信号として取り出すことができる。CPU461は、その電気信号をデジタル形式で受け、その値をRAM462に記憶することができる。分光素子370が第1の波長～第Nの波長までの範囲の光を選択的に受光素子380に導くことで、CPU461は、ラマンスペクトルをデジタル形式でRAM462に記憶することができる。

#### 【0068】

図4の例では、CPU461は、RAM462に記憶される標的物に特有のラマンスペクトルデータと例えばROM463に予め記憶される既知のラマンスペクトルデータとを比較することができます。CPU461は、比較結果に基づき標的物が何の物質であるか否かを判定することができます。CPU461は、比較結果又は判定結果を表示部540に送ることができます。これにより、表示部540は、比較結果又は判定結果をユーザーに示すことができる。また、CPU461は、比較結果又は判定結果を表すデータを通信接続口510から出力することもできる。インターフェース530は、CPU461と通信接続口510に接続される外部機器(図示せず)との間のデータの受け渡しを所与の規格で実行することができる。

#### 【0069】

図4の例では、CPU461は、電力供給部470の状態を判定することができます。電力供給部470が例えば1次電池又は2次電池で構成される場合、CPU461は、1次電池又は2次電池の電圧を表すデータが例えばROM463に予め記憶される所与の値以下であるか否かを判定することができます。CPU461は、判定結果を表す信号を表示部540に送ることができます。これにより、表示部540は、判定結果(例えば電池切れ、充電要)又は判定結果に基づく指示をユーザーに示すことができる。また、電力供給部470が例えば2次電池で構成される場合、CPU461は、2次電池が充電されているか否か等を判定することができます。

#### 【0070】

図4の例では、電力供給部470は、電力供給部470の状態をCPU461に送ることができる。また、電力供給部470は、CPU461等を有する処理部460に電力を供給することができる。図4に示されていないが、電力供給部470は、光源ドライバー15、受光回路385、光源群1等の検出装置を構成する部品にも電力を供給することができる。

#### 【0071】

##### 2.2. 光源

図5は、垂直共振器面発光レーザーの構造例を示す。図5の例では、n型GaN基板

10

20

30

40

50

の上に n 型 D B R (Diffracted Bragg Reflector)層が形成される。n 型 D B R (Diffracted Bragg Reflector)層の中央部に活性層及び酸化狭窄層が設けられる。活性層及び酸化狭窄層の上に p 型 D B R 層が設けられる。p 型 D B R 層及び n 型 D B R 層の上に絶縁層を設け、絶縁層の上に電極を形成する。n 型 G a A s 基板の裏側にも電極を形成する。図 5 の例では、n 型 D B R 層と p 型 D B R 層との間に活性層が介在し、活性層で発生した光が n 型 D B R 層と p 型 D B R 層との間で共振する垂直共振器が形成される。なお、垂直共振器面発光レーザーは、図 5 の例に限定されず、例えば酸化狭窄層を省略してもよい。

#### 【 0 0 7 2 】

例えば図 1 (A) 等に示される光源群 1 の複数の光源の各々は、基板面に対して垂直方向に光を共振させ、基板面と垂直な方向（光源の光軸 L a x 1）に光を放出可能な垂直共振器面発光レーザー（広義には面発光レーザー）であることが好ましい。垂直共振器面発光レーザーを利用することで、単色（单一波長）で且つ直線偏光である光源を構成することができる。また、垂直共振器面発光レーザーは、小型化することが可能であり、携帯型の検出装置への組み込みに適している。また、垂直共振器面発光レーザーの構造から、製造工程では基板を劈開せずとも共振器の形成やレーザー特性の検査が可能であり、大量生産に向いている。さらに、垂直共振器面発光レーザーは、他の半導体レーザーに比べて比較的安価に製造が可能であり、例えば 2 次元アレー型の垂直共振器面発光レーザーを提供することもできる。加えて、垂直共振器面発光レーザーの閾値電流が小さく、従って、検出装置の消費電力を低減させることができる。また、低電流でも垂直共振器面発光レーザーの高速変調が可能であり、垂直共振器面発光レーザーの温度変化に対する特性変化の幅が少なく、垂直共振器面発光レーザーの温度制御部を簡易化できる。

10

20

30

#### 【 0 0 7 3 】

なお、図 5 の例を変形して、垂直共振器面発光レーザーは、安定した偏光面（広義には偏光方向）を提供することができる。この場合、図 3 の偏光制御素子 330 の代わりに、例えば図 3 の 3 つの光源 A ~ C（垂直共振器面発光レーザー）の各々は、例えば特許文献 2 で開示されるような歪み付加部を有することができる。特許文献 2 の例では、特許文献 2 の歪み付加部 19 は、垂直共振器面発光レーザーの共振器 10B に隣接して配置される。特許文献 2 の歪み付加部 19 は、特許文献 2 の共振器 10B に異方的な応力をあたえ、歪ませることによって、複屈折、利得の偏光依存性を特許文献 2 の共振器 10A 内に生じさせる。これによって、安定した偏光面を提供することができる。

#### 【 0 0 7 4 】

図 6 (A)、図 6 (B)、図 6 (C)、図 6 (D) は、複数の光源の配置例を示す。図 6 (A) の例では、1 次元アレー型の垂直共振器面発光レーザーは、4 つの光源 A ~ D で構成され、4 つの光源 A ~ D の各々は、歪み付加部を有する。図 6 (A) の例では、光源 A は、偏光方向 DA を有する光を放射可能である。残りの光源 B ~ D は、それぞれ、偏光方向 DB ~ DD を有する光を放射可能である。図 6 (B) の例は、4 つの光源 A ~ D で構成される 2 次元アレー型の垂直共振器面発光レーザーを表す。

#### 【 0 0 7 5 】

図 6 (C) の例では、2 次元アレー型の垂直共振器面発光レーザーは、4 つの光源 A ~ D 及び 4 つの光源 A2 ~ D2 で構成される。図 6 (C) の例を変形して、図 6 (D) の例を採用してもよい。4 つの光源 A ~ D を第 1 の光源群 1 と呼ぶとき、4 つの光源 A2 ~ D2 を第 2 の光源群 2 と呼ぶことができる。第 2 の光源群 2 の複数の光源 A2 ~ D2 の各々は、第 1 の光源群 1 の複数の光源 A ~ D のいずれか 1 つに対応する。例えば図 6 (C) の例では、光源 A2 が光源 A に対応し、光源 A2 は、有効な状態で、光源 A の偏光方向 DA と等しい偏光方向 D A を有する光を放射可能である。残りの光源 B2 ~ D2 は、それぞれ、光源 B ~ D に対応し、有効な状態で、光源 B ~ D の偏光方向 DB ~ DD と等しい偏光方向 D B ~ D D を有する光を放射可能である。

40

#### 【 0 0 7 6 】

例えば図 1 (D) の例では、第 1 の光源群の光源 A ~ C を順次に切り替えて、検出部 5 が所与の強度以下でラマン散乱光を検出する場合、切り替え部 6 は、光源 D を選択し、

50

光源 D の電源だけを ON させることができる。しかしながら、光源 D を有効にさせて、検出部 5 が所与の強度以下でラマン散乱光を検出し続けることもある。このような場合、検出部 5 が最も高い強度を有するラマン散乱光を検出することが好ましい。加えて、例えば図 1 ( D ) の例を変形して、検出装置は、例えば図 6 ( C ) で示されるような第 2 の光源群 8 をさらに含むことが好ましい。

#### 【 0 0 7 7 】

例えば、切り替え部 6 が第 1 の光源群 1 の複数の光源 A ~ D の中から光源 D を有効にさせ、且つ検出部 4 が所与の強度以下でラマン散乱光を検出する場合、切り替え部 6 は、光源 D 及び光源 D 2 の双方を有効にさせることができる。このようにすれば、検出部 4 は、例えば偏光方向 D D が等しい 2 つの光源 D 及び D 2 によるラマン散乱光を所与の強度より大きい強度で検出することができる可能性が高まる。なお、図 6 ( C ) の例を変形して、偏光方向が等しい 3 つ以上の光源を準備してもよい。

10

#### 【 0 0 7 8 】

図 7 は、光源の特性の説明図を示す。図 7 の例では、光源に利用可能なレーザーの特性を表で表している。垂直共振器面発光レーザー ( V C S E L ) は、上述のように検出装置の光源に適しているが、検出装置は、図 7 に示すような他のレーザーを採用してもよく、レーザー以外の光源を採用してもよい。

#### 【 0 0 7 9 】

##### 2 . 3 . 光デバイス ( フォトリソグラフィー法による金属ナノ構造 )

図 8 ( A ) 、図 8 ( B ) 、図 8 ( C ) 、図 8 ( D ) 、図 8 ( E ) は、フォトリソグラフィー法の概要説明図を示す。図 8 ( A ) の例では、紫外レーザーを利用した光干渉露光装置の概要を示され、光源として、例えば波長 2 6 6 nm 、出力 2 0 0 mW を有する連続発振 ( CW:Continuous Wave ) レーザー用いることができる。紫外レーザーからの光は、シャッターを経由してミラーで折り返し、ハーフミラーで両側に分岐する。ハーフミラーから分岐される 2 つの光の各々は、ミラーで折り返し対物レンズ及びピンホールを経由し、これにより、光のビーム径が広がる。ビーム径が広がった紫外レーザーからの光をマスクに照射することで露光パターンを作り、レジストを塗布した基板 1 0 0 に露光パターンを照射することができる。この時、両側のマスクからの露光パターンが互いに干渉することにより、干渉パターンをレジスト ( 基板 1 0 0 ) に形成することができる。また、露光パターンを例えばハーフミラー及び C C D カメラを介してモニタで確認することもできる。

20

#### 【 0 0 8 0 】

所与の干渉パターン ( 広義には所与の露光パターン ) をレジスト ( 基板 1 0 0 ) に露光した後、レジストを現像し、必要な部分のみのレジストを残すことができる。その後、基板 1 0 0 をエッチングする溶液に浸漬するか、ドライエッチングで必要な量だけエッチングすることができる。エッチング後、基板 1 0 0 上に残っているレジストを除去することができる。これにより、基板 1 0 0 の表面を微細な凹凸状に加工することができる。その後、基板 1 0 0 の表面に電気伝導体として例えば金属微粒子を付加し、金属ナノ構造を形成することができる。金属ナノ構造の製造プロセスの概要については、後述する ( 図 9 ( A ) ~ 図 9 ( E ) 参照 ) 。

30

#### 【 0 0 8 1 】

図 8 ( B ) の例では、金属ナノ構造を有する基板 1 0 0 が平面図及び断面図で示されている。この例では、基板 1 0 0 ( 金属ナノ構造 ) は、複数の突起 1 1 0 で構成される突起群 1 1 5 を有し、複数の突起 1 1 0 ( 金属微粒子 2 0 ) は、1 次元の周期で配置される。

40

#### 【 0 0 8 2 】

また、図 8 ( C ) の例でも、金属ナノ構造を有する基板 1 0 0 が平面図及び断面図で示されている。この例では、複数の突起 1 1 0 ( 金属微粒子 2 0 ) は、2 次元の周期で配置される。図 8 ( D ) の例では、金属ナノ構造を有する基板 1 0 0 が斜視で示される電子顕微鏡写真が示され、例えば図 8 ( C ) に対応している。図 8 ( D ) の例では、金属ナノ構造を有する基板 1 0 0 が平面視で示される S E M 写真が示され、例えば図 8 ( C ) に対応

50

している。例えば金(Au)で構成される複数の突起110の周期(ピッチ)は、例えば約140nmである。

#### 【0083】

なお、光干渉露光装置の代わりに例えば電子ビーム露光装置を用いて金属ナノ構造を形成してもよい。電子ビーム露光装置は、光干渉露光装置と比べて露光の自由度が高いという利点を有する一方、光干渉露光装置は、電子ビーム露光装置と比べて光デバイスの量産性が高いという利点を有する。

#### 【0084】

図9(A)、図9(B)、図9(C)、図9(D)、図9(E)は、金属ナノ構造の製造プロセスの概要説明図を示す。以下では、図8(B)等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。例えば図8(C)等で示される金属ナノ構造は、具体的には、以下のように製造することができる。図9(A)で示すように、基板100は、レジスト101を有する。レジスト101は、例えばスピンドルコートによって基板100に塗布され、その後、乾燥される。レジスト101に所与のパターンを露光するには、例えば図8(A)で示されるような光干渉露光装置を用いることができる。レジスト101は、例えばポジ型レジストを使用することができ、レジスト101の膜厚は、例えば1μmである。図9(A)の例では、2つの方向から光をレジスト101に照射し、2つの光の各々は、例えば格子状の露光パターンを有する。2つの光が交差する角度によって、様々な干渉パターンを形成することができる。なお、干渉パターンの大きさは、光干渉露光装置の例えば紫外レーザーの波長の半分まで小さくすることができる。干渉パターンによる潜像をレジスト101内に形成し、レジスト101を現像すると、例えば図9(B)に示すようなレジストパターンを形成することができる。

10

20

30

#### 【0085】

図9(B)に示されるように、基板100は、レジストパターンで保護されている部分とレジストパターンで保護されていない部分とを有する。その後、レジストパターンで保護されていない部分をエッティングして、例えば図9(C)に示されるように、基板100に凹部104が形成される。その後、基板100に残ったレジスト101を除去することで、例えば図9(D)に示すような基板100の凸部105が露出する。その後、例えばスパッター装置で金属微粒子20による金属膜を基板100に形成する。初期状態では基板100全体に薄く金属膜が形成されるが、凸部105付近に多く金属微粒子20が徐々に付着し、例えば図9(E)に示されるような金属膜で複数の突起110(金属ナノ構造)を形成することができる。

#### 【0086】

複数の突起110(金属ナノ構造)を有する突起群115に例えば直線偏光のレーザー光を照射すると、レーザー光の偏光方向により局在プラズモンが励起され、突起群115の隣り合う突起110間のギャップに強い増強電場が形成される。突起群115の隣り合う突起110間のギャップは、金属膜の膜厚によって制御することができ、このギャップの大小が増強電場の強さを主に支配する要因となる。

#### 【0087】

金属微粒子20又は金属膜は、例えば金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、パラジウム(Pd)又は白金(Plt)で構成することができ、また、これらの合金(組み合わせ)で構成することができる。好ましくは、金属微粒子20又は金属膜は、金(Au)又は銀(Ag)で構成し、局在プラズモン、増強電場又は表面増強ラマン散乱を発現し易くすることができる。

40

#### 【0088】

図10(A)、図10(B)は、金属ナノ構造で形成される増強電場の概要説明図を示す。以下では、図2(D)等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。標的分子(気体試料)は、例えば図3に示す吸引口400から誘導部420の内部に吸引され、センサーチップ300(広義には光デバイス4)付近の流路422に到達する。図10(A)の例では、光デバイス4は、金属ナノ構造を有し、金属

50

ナノ構造に光源からの光 L i n (入射光) を照射すると、凸部 105 のギャップに増強電場が形成される。図 10 (B) の例では、光 L i n (入射光) の照射範囲が点線で示されている。なお、増強電場に標的分子が入った場合には、その標的分子の振動数の情報を含んだラマン散乱光が生じる。また、そのラマン散乱光が増強電場によって増強され、表面増強ラマン散乱が生じる。

#### 【0089】

凸部 105 のギャップが小さく、凸部 105 の高さ (凹部 104 の深さ) が大きくなると、例えば図 10 (A) 等で示される増強電場は、一般に、強くなる。また、光 L i n (入射光) の強度が強ければ、増強電場も強くなる。但し、凸部 105 のギャップが狭すぎると、標的分子がギャップ (増強電場) に入る確率も低くなるので、凸部 105 のギャップは、例えば数 nm ~ 10 数 nm に設定することができる。また、凸部 105 の高さ (凹部 104 の深さ) が大きくなると、標的分子がギャップ (増強電場) に一旦入った後に、ギャップ (増強電場) を出る時間を長くさせ、ラマン散乱光を表す検出信号又はラマンスペクトルは、安定する。

10

#### 【0090】

また、金属ナノ構造の金属の種類によって光 L i n (入射光) の波長を選択することができる。金属ナノ構造が例えば金 (Au) で構成される場合、光 L i n の波長を例えば 633 nm に設定することができる。また、金属ナノ構造が例えば銀 (Ag) で構成される場合、光 L i n の波長を例えば 514 nm に設定することができる。また、標的分子の種類によって光 L i n の波長を選択することもできる。なお、気体試料が標的分子以外の不純物を含む場合、不純物の蛍光を抑制するために、光 L i n の波長を例えば 780 nm 程度に設定してもよい。

20

#### 【0091】

##### 2.4. 表面プラズモン共鳴ピーク

例えば図 10 (A) 等に示される光デバイス 4 の金属ナノ構造 (広義には電気伝導体) に光 L i n (入射光) を照射する時、一般には、プロードな表面プラズモン共鳴ピークがひとつしか存在しないため、励起波長 (レイリー散乱波長と等しい) とラマン散乱波長に對して、共鳴ピークの位置を適切な位置に設定する必要がある。そのため、共鳴ピーク波長を励起波長とラマン散乱波長の間に設定すれば、励起過程とラマン散乱過程の両方で電場増強効果を期待できる。しかしながら、共鳴ピークがプロードであるため、個々の過程では共鳴の強さが弱くなり、過程全体の増強度は十分とは言えないこともある。そこで、光デバイス 4 に入射光を斜めに入射して共鳴ピークを 2 つ生じさせ、その 2 つの共鳴ピークを励起波長とラマン散乱波長に設定することで、検出感度又はセンサー感度を向上させることができる。

30

#### 【0092】

表面増強ラマン散乱を応用した高感度なセンサーチップ 300 (広義には光デバイス 4) を実現するためには、局所電場の増強度 (以下、増強度と適宜省略する) ができるだけ大きいことが望ましい。増強度  $r_{ay}$  は、下式 (1) で表される (M. Inoue, K. Ohtaka, J. Phys. Soc. Jpn., 52, 3853 (1983))。ここで、 $r_{ay}$  は、励起波長における増強度であり、 $r_{am}$  は、ラマン散乱波長における増強度である。

40

$$= r_{ay} \times r_{am} \quad (1)$$

上式 (1) より、励起過程における増強度とラマン散乱過程における増強度の両方を同時に高め、表面増強ラマン散乱過程における増強度を高めることができる。そのため例えば図 11 に示すように、励起波長及びラマン散乱波長の近傍だけに強い 2 つの共鳴ピークを発生させる。これにより、両散乱過程の相乗効果によって、局所電場の増強効果を高めることができる。

#### 【0093】

図 12 は、センサーチップの構成例の斜視図である。図 12 に示されるように、センサーチップ 300 は、基板 100 (基材) 及び突起群 115 (第 1 の突起群) を含む。複数の突起 110 を有する突起群 115 は、電気伝導体で構成され、電気伝導体は、典型的に

50

は金属（例えば、金（Au））であるが、半導体（例えばポリシリコン）等でもよい。

#### 【0094】

複数の突起110は、基板100の平面（広義には仮想平面）に沿った第1の方向D1に周期的に配置される。ここで、基板100の平面は、例えば突起群115が形成される側の基板100の表面120であり、表面120に平行な面でもよい。より具体的には、突起群115の各突起110は、突起の配列方向（第1の方向D1）の断面形状が基材100の表面120から凸形状に形成される。凸形状は、矩形や台形、円弧等であり、例えば図8（D）、図9（E）等で示されるような複雑な曲線で定義される断面形状を有してもよい。例えば、図12に示すように、突起群115は、基板100に対する平面視において、第1の方向D1に直交する第2の方向D2に平行な縞状に形成される。

10

#### 【0095】

図13は、図12のセンサーチップの断面図を示す。この断面図の断面は、基板100の平面に垂直な面であり、突起群115の配列方向（第1の方向D1）に平行な面である。図13に示すように、基板100の平面の法線方向を第3の方向D3とする。

#### 【0096】

図13の例では、基板100は、ガラス基板130と、ガラス基板130の上に形成された金属薄膜140とを有する。例えば、金属薄膜140の厚さは150nm以上である。図13の例では、突起群115の断面形状は矩形（略矩形）であり、第1の高さH1の突起110が、第1の方向D1に沿って第1の周期P1で配列される。この金属薄膜140と突起群115とにより金属格子150（周期的な金属凹凸構造）が形成される。第1の周期P1は例えば100～1000nmの範囲に設定され、第1の高さH1は例えば10～100nmの範囲に設定されることが望ましい。なお、ガラス基板130は、例えば石英基板、サファイア基板等でもよく。基板100は、例えば金属からなる平板を用いてもよい。

20

#### 【0097】

センサーチップ300には、直線偏光を含む入射光Linを入射することができる。直線偏光の偏光方向（偏光方位）は、第1の方向D1と第3の方向D3に平行な面に対して平行な方向である。図13の例では、入射光Linは、金属薄膜140と突起群115による金属格子150（広義には電気伝導体）に対して傾斜させて入射させる。具体的には、傾斜角を $\theta$ とすると、 $\theta > 0$ であり、図13に示す断面において入射方向と第3の方向D3の反対方向との角度（基板100の平面に向う垂線に対する角度）が $\theta$ となるように入射光を入射させる。

30

#### 【0098】

好ましくは、直線偏光は、第1の方向D1と第3の方向D3に平行な面に対して平行である。しかしながら、直線偏光は、第1の方向D1と第3の方向D3に平行な面に対して非平行であってもよい。言い換えれば、直線偏光は、第1の方向D1と第3の方向D3に平行な面に平行な偏光成分を含んでいればよい。なお、直線偏光の偏光方向は、例えば図3の偏光制御素子330、図6（A）の歪み付加部等で設定することができる。

#### 【0099】

例えば図6（A）で示されるような複数の光源を切り替えることにより、入射光Linの偏光方向を設定できる。これにより、最も大きい強度を有するラマン散乱光を検出することができる。但し、1つの光源を有効にするだけでは、所与の強度よりも大きいラマン散乱光を検出できない場合、例えば図6（C）で示されるような同一の偏光方向を有する光を放出可能な複数の光源を有効にしてもよい。

40

#### 【0100】

図14は、センサーチップの反射光強度の特性例を示す。図14は、金属格子150を銀（Ag）により形成し、金属格子150に対する光の入射角度 $\theta$ が3度であり、光の偏光方向が金属格子150の溝方向（第2の方向D2）と直交し、突起110の断面が矩形（略矩形）であり、第1の周期P1が500nmであり、第1の高さH1が20nmである場合の特性例である。図14の例では、横軸は反射光の波長を表し、縦軸は反射光強度

50

(入射光強度に対する比率)を表す。

#### 【0101】

図14の例では、金属格子150には、表面プラズモンポラリトン(SPP:Surface Plasmon Polariton)の共鳴ピークが2つ存在する。例えば、1つの共鳴ピーク波長 $p_1$ は、515 nm付近に位置し、もう1つの共鳴ピーク波長 $p_2$ は、555 nm付近に位置する。この2つの共鳴ピーク波長 $p_1$ 及び $p_2$ を、それぞれ、励起波長 $\theta_1$ 及びラマン散乱波長 $\theta_2$ の近傍に合わせる又は一致させることにより、大きな増強ラマン散乱効果が期待できる。例えば、波長515 nmのアルゴンレーザーを励起波長 $\theta_1$ として用いた場合、波長555 nm近傍のラマン散乱光(ラマンシフト $1200\sim1600\text{ cm}^{-1}$ )を強く増強させることが可能となる。

10

#### 【0102】

図15は、表面プラズモンポラリトンの励起条件の説明図を示す。図15に示すC1は、表面プラズモンポラリトンの分散曲線(例えば、空気と金(Au)の境界面での分散曲線)を表し、C2は、ライトラインを表す。図15では、金属格子150の周期を第1の周期 $P_1$ とし、この場合の格子ベクトルの波数 $2/\theta_1$ を横軸上に示す。

#### 【0103】

まず、金属格子150と励起条件の関係について説明する。入射光 $L_{in}$ の波数を $k_i$ とし、入射角度 $\theta$ とすると、金属格子150の配列方向(図13に示す第1の方向 $D_1$ 、または第1の方向 $D_1$ の反対方向)における1次のエバネッセント波の波数は、 $2/\theta_1 \pm k_i \cdot \sin\theta$ である。表面プラズモンポラリトンは、このエバネッセント波の波数 $2/\theta_1 \pm k_i \cdot \sin\theta$ と表面プラズモンの波数が一致した場合に励起される。すなわち、表面プラズモンポラリトンの励起条件は、エバネッセント波の生成条件を表す直線と表面プラズモンポラリトンの分散曲線との交点により表される。

20

#### 【0104】

図15のC3に、比較例として、金属格子150に対して垂直( $\theta = 0$ )に光を入射させた場合のエバネッセント波の生成条件を表す直線を示す。C3に示すように、この場合のエバネッセント波の波数は $2/\theta_1$ で表される。この直線C3は、格子ベクトルの波数の位置から上へ延ばした線であり、表面プラズモンポラリトンの分散曲線C1と交わる。このとき、交点は1つであり、周波数 $\theta_0$ (角周波数)に対応する共鳴ピークが現れる。

30

#### 【0105】

C4とC5に、エバネッセント波の生成条件を表す直線を示す。金属格子150に対して角度( $\theta > 0$ )で光を入射させる場合、エバネッセント波の波数は $2/\theta_1 \pm k_i \cdot \sin\theta$ で表される。直線C4は、 $2/\theta_1 + k_i \cdot \sin\theta$ に対応し、直線C5は、 $2/\theta_1 - k_i \cdot \sin\theta$ に対応する。これらの直線C4とC5は、格子ベクトルの波数の位置から角度 $\theta$ で斜め上に延ばした線であり、表面プラズモンポラリトンの分散曲線C1と2点(周波数 $\theta_+$ ,  $\theta_-$ )で交わる。従って、周波数 $\theta_+$ ,  $\theta_-$ に対応する2つの共鳴ピークが、共鳴ピーク波長 $p_1$ ,  $p_2$ で現れる。

#### 【0106】

表面プラズモンポラリトンの励起条件を利用して2つの共鳴ピーク波長 $p_1$ ,  $p_2$ を設定し、その2つの共鳴ピーク波長 $p_1$ ,  $p_2$ を表面増強ラマン散乱に利用することができる。具体的には、まず厳密結合波解析(RCWA:Rigorous Coupled Wave Analysis)により分散曲線C1を求める(L.Li and C.W.Haggans, J.Opt.Soc.Am., A10, 1184-1189(1993))。分散曲線C1は、金属の種類や、媒質の種類や、金属格子150の断面形状に固有の曲線である。次に、所与の格子周期(例えば第1の周期 $P_1$ )と所与の入射角度 $\theta$ を、標的物のラマンシフトに応じて決定する。すなわち、第1の共鳴ピーク波長 $p_1$ を励起波長 $\theta_1$ (レイリー散乱波長)の近傍に設定し、第2の共鳴ピーク波長 $p_2$ ( $p_2 > p_1$ )をラマン散乱波長 $\theta_2$ の近傍に設定する。そして、分散曲線C1と $\theta = \theta_+$ ( $= p_1$ )の交点を直線C4通り、分散曲線C1と $\theta = \theta_-$ ( $= p_2$ )の交点を直線C5通りのように、所与の第1の周期 $P_1$ と所与の入射角度 $\theta$ を設定することができ

40

50

る。

【0107】

図14の例では、第1の共鳴ピーク波長  $p_1$  を含む第1の共鳴ピーク波長帯域  $BW_1$  は、表面増強ラマン散乱における励起波長  $\lambda_1$  を含む。第2の共鳴ピーク波長  $p_2$  を含む第2の共鳴ピーク波長帯域  $BW_2$  は、表面増強ラマン散乱におけるラマン散乱波長  $\lambda_2$  を含む。共鳴ピーク波長帯域  $BW_1$ ,  $BW_2$  がそれぞれ共鳴ピーク波長  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  を含むように第1の周期  $P_1$  及び入射角度  $\theta$  等が設定されることで、励起波長  $\lambda_1$  における電場増強度とラマン散乱波長  $\lambda_2$  における電場増強度を向上できる。

【0108】

ここで、共鳴ピーク波長帯域  $BW_1$ ,  $BW_2$  は、所与の反射光強度での帯域幅であり、  
10 例えればピークの半値幅でもよい。なお、図14では、 $\lambda_1 = p_1$ ,  $\lambda_2 = p_2$  としているが、 $\lambda_1$  と  $p_1$  は異なってもよく、 $\lambda_2$  と  $p_2$  は異なってもよい。

【0109】

図16は、センサーチップの反射光強度の他の特性例を示す。図16は、金属格子150を金(Au)により形成し、金属格子150に対する光の入射角度  $\theta$  が5度であり、光の偏光方向が金属格子150の溝方向(第2の方向D2)と直交し、突起110の断面が矩形(略矩形)であり、第1の周期  $P_1$  が500nmであり、第1の高さ  $H_1$  が40nmである場合の特性例である。

【0110】

図16の例では、1つの共鳴ピーク波長  $p_1$  は、545nm付近に位置し、もう1つの共鳴ピーク波長  $p_2$  は、600nm付近に位置する。この2つの共鳴ピーク波長  $p_1$  及び  $p_2$  を、それぞれ、励起波長  $\lambda_1$  及びラマン散乱波長  $\lambda_2$  の近傍に合わせる又は一致させることにより、大きな増強ラマン散乱効果が期待できる。  
20

【0111】

図16の例では、図14の例と比べて、2つの共鳴ピークがややブロードであり、且つ浅くなっている。しかしながら、共鳴ピークを1つしか利用しない場合と比べて、表面増強ラマン散乱の信号を増強する効果は優れている。また、金(Au)を用いることで、酸化や硫化等による表面劣化を抑止できる。

【0112】

図17は、図12のセンサーチップの変形例の斜視図を示す。以下では、図12等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。図12の例では、入射光  $L_{in}$  として、偏光方向の基板100の平面に平行な成分(偏光方向の基板100の平面に対する正射影)と第1の突起群115の配列方向(第1の方向D1)とが平行である直線偏光が入射されることが好ましい。このようにすれば、直線偏光によって自由電子プラズマの粗密波が第1の方向D1に沿った方向に誘起され、第1の突起群115の配列方向に沿って伝搬する表面プラズモンを励起できる。  
30

【0113】

図17の例では、第1の突起群115の頂面220に、金属により形成される第2の突起群205を含むことができる。第2の突起群205の複数の突起200の各々は、基板100の平面に平行な方向(第1の方向D1)に沿って、第1の周期  $P_1$  よりも短い第2の周期  $P_2$  ( $P_2 < P_1$ ) で配列される。  
40

【0114】

また、図17の例では、第1の突起群115が配列される面であって第1の突起群115の隣り合う突起110間の面(第1の突起群115の隣り合う突起110間の底面230)に、金属により形成される第3の突起群215を含むことができる。第3の突起群215の複数の突起210の各々は、基板100の平面に平行な方向(第1の方向D1)に沿って、第1の周期  $P_1$  よりも短い第3の周期  $P_3$  ( $P_3 < P_1$ ) で配列される。

【0115】

このようにすれば、第1の突起群115により伝搬型の表面プラズモンが励起され、その伝搬型の表面プラズモンにより第2の突起群205や第3の突起群215に局在型の表  
50

面プラズモンが励起される。これにより、励起波長 1 とラマン散乱波長 2 における電場増強度をさらに向上できる。

#### 【0116】

第2の突起群 205 と第3の突起群 215 の各突起 200, 210 は、突起 200, 210 の配列方向（第1の方向 D1）の断面形状が頂面 220 と底面 230 から凸形状に形成される。凸形状は、矩形や台形、円弧等である。例えば、図17に示すように、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 は、基板 100 に対する平面視において、第2の方向 D2 に平行な縞状に形成される。この第2の突起群 205 と第3の突起群 215 は、第1の突起群 115 と同じ金属により形成されてもよく、異なる金属により形成されてもよい。

10

#### 【0117】

図18に、図17のセンサーチップの断面図を示す。この断面図の断面は、基板 100 の平面に垂直な面であり、第1の方向 D1 に平行な面である。図18に示すように、頂面 220 からの第2の高さ H2 の突起 200（第2の突起群 205）が、第1の周期 P1 より短い第2の周期 P2 で配列される。底面 230 からの第3の高さ H3 の突起 210（第3の突起群 215）は、第1の周期 P1 より短い第3の周期 P3 で配列される。例えば、第2の周期 P2 や第3の周期 P3 は、500 nm 以下に設定することが望ましく、第2の高さ H2 や第3の高さ H3 は、200 nm 以下に設定することが望ましい。なお、第3の高さ H3 は、H3 > H1 であってもよく、H3 = H1 であってもよい。

20

#### 【0118】

図18の例では、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 の配列方向が、第1の突起群 115 と同じ配列方向（第1の方向 D1）である。しかしながら、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 の配列方向は、第1の方向 D1 と異なる方向であってもよい。この場合、第2の周期 P2 や第3の周期 P3 は、第1の方向 D1 における配列周期となる。

30

#### 【0119】

上述のように、第1の突起群 115 により、励起波長 1（レイリー散乱波長）とラマン散乱波長 2 に2つの共鳴ピークをもつ伝搬型の表面プラズモンが励起される。この表面プラズモンは、金属格子 150 の表面に沿って伝搬し、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 に局在型の表面プラズモンを励起する。そして、この局在型の表面プラズモンは、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 の突起 200, 210 間に増強電場を励起し、その増強電場と標的物との相互作用により表面増強ラマン散乱が生じる。このとき、第2の突起群 205 や第3の突起群 215 の突起 200, 210 間隔が狭いため、突起 200, 210 間に強い増強電場が励起される。そのため、突起 200, 210 間に吸着した標的物が1個～数個であっても、その増強電場によって強い表面増強ラマン散乱を生じさせることができる。

30

#### 【0120】

##### 2.5. 入射角

図19(A)、図19(B)は、センサーチップに入射光を傾斜させて入射させるための手法の説明図を示す。以下では、図1(B)等で説明した構成要素と同一の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。図19(A)の例では、光源の光軸 L<sub>a x 1</sub>を対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>からずらすことで、センサーチップ 300 に対して入射光 L<sub>i n</sub>を傾斜させる。図19(B)の例では、光源の光軸 L<sub>a x 1</sub>を対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>と一致させ、対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>に対してセンサーチップ 300 を傾斜させて配置することで、センサーチップ 300 に対して入射光 L<sub>i n</sub>を傾斜させる。

40

#### 【0121】

図19(A)の例では、対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>に対して垂直にセンサーチップ 300 を支持部 430 上に配置する。そして、有効になった1つの光源の光軸 L<sub>a x 1</sub>を所与の距離だけ対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>から離して、対物レンズ 3 の光軸 L<sub>a x 2</sub>と平行に入射光 L<sub>i n</sub>を対物レンズ 3 に入射する。所与の距離は、センサーチップ 300 に対する入射光 L<sub>i n</sub>の入射角度が対物レンズ 3 の屈折によって となる距離である。センサー

50

チップ 300 から光  $L_{out}$  は、対物レンズ 3 に入射され、対物レンズ 3 によって例えば図 1 のハーフミラー 2 等へ導かれる。

#### 【0122】

図 19 (B) の例では、センサーチップ 300 の平面（基板 100 の平面）の法線と、対レンズ 3 の光軸  $L_{ax2}$  との成す角度を  $\theta$  に配置する。そして、対物レンズ 3 の光軸  $L_{ax2}$  に沿って、有効になった 1 つの光源からの入射光  $L_{in}$  を入射させる。そうすると、入射光  $L_{in}$  は対物レンズ 3 によって屈折されず、センサーチップ 300 に対して入射角度  $\theta$  で入射される。センサーチップ 300 を傾斜させるために、図 19 (B) に示すように支持部 430 を傾斜させることができる。なお、図 19 (B) の例を変形して、支持部 430 の支持面を傾斜面としてもよい。

10

#### 【0123】

##### 2.6. 光デバイス（蒸着による金属ナノ構造）

図 20 (A)、図 20 (B) は、電気伝導体の製造方法の概要説明図を示す。例えば図 8 (A) 等で示すフォトリソグラフィー法で作製する金属ナノ構造はトップダウン法とも言われ、金属ナノ構造は、規則的な配列構造を持ち、増強電場が形成される間隙部も揃っている。それに対して、蒸着によって形成される独立したアイランド状の金属ナノ構造は、大きさや形が均一ではなく、増強電場が形成される間隙部も均一にならない。つまり、増強電場の強いところと弱いところ、入射光  $L_{in}$  の偏光方向も自由度がある。しかし、この蒸着による金属ナノ構造では、どこかに強い増強電場を形成する条件を含んでいるため、製造バラツキを吸収できるというメリットがある。

20

#### 【0124】

例えば真空蒸着機を利用して、蒸着による金属ナノ構造を製作することができる。蒸着条件の 1 例は、基板 100 に硼珪酸ガラスを採用することができる。また、蒸着金属として、銀 (Ag) を採用し、銀 (Ag) を基板 100 に加熱蒸着させることができる。この時、基板 100 は、加熱する必要はなく、加熱蒸着のレートは、例えば 0.03 ~ 0.05 nm/sec に設定することができる。

#### 【0125】

図 20 (A) には、島状のアイランドが形成されていく過程を模式的に示してある。蒸着アイランドの初期では、基板 100 上に銀 (Ag) の核が形成される。蒸着アイランドの成長期では、核を中心に銀 (Ag) が成長し大きくなる。蒸着アイランドの完成期では、隣接するアイランド同士の隣接する距離が小さくなるが、隣接するアイランドがくっ付かない段階で真空蒸着を止めることができる。

30

#### 【0126】

図 20 (B) には実際に製作した金属ナノ構造の電子顕微鏡写真を示してある。およそ 25 nm 程度の Ag アイランドが形成され、それぞれが独立していることが分かる。これ以上蒸着を継続すると Ag アイランド同士が繋がってきて、ついには膜状になってしまう。通常は均一な膜状に蒸着することが求まるが、この場合にはできるだけ独立した Ag アイランドが狭く高密度に形成されることが望ましい。

40

#### 【0127】

このような金属ナノ構造に直線偏光の光を照射すると、蒸着アイランド間のギャップ近傍に強い増強電場が形成されるが、ギャップの位置や向きなどは一定に揃っていない。増強電場に寄与するのは、そのギャップの向きに合った入射光  $L_{in}$  の内の p 偏光波であり、偏光方向によって強く増強電場が形成される場合と、少し弱くなる場合がある。例えば図 6 (A) で示されるような複数の光源を切り替えることにより、入射光  $L_{in}$  の偏光方向を変更できる。これにより、所与の強度よりも大きいラマン散乱光又は最も大きい強度を有するラマン散乱光を検出することができる。

#### 【0128】

##### 2.7. 分光分析

図 21 (A)、図 21 (B)、図 21 (C) は、ラマンスペクトルのピーク抽出の概要説明図を示す。図 21 (A) は、ある物質に励起レーザーを照射した時に検出されるラマ

50

ンスペクトルを示し、ラマンシフトを波数で表している。図21(A)の例では、第1のピーク( $883\text{ cm}^{-1}$ )と第2のピーク( $1453\text{ cm}^{-1}$ )が特徴的と考えられる。得られたラマンスペクトルと予め保持するデータ(第1のピークのラマンシフト及び光強度、第2のピークのラマンシフト及び光強度等)と照合することで、標的物を特定することができる。

#### 【0129】

図21(B)は、解像度が粗い( $40\text{ cm}^{-1}$ )分光素子370で受光素子380が第2のピークの周辺のスペクトルを検出した時の信号強度(白丸)を示す。図21(C)は、解像度が細かい( $10\text{ cm}^{-1}$ )分光素子370で受光素子380が第2のピークの周辺のスペクトルを検出した時の信号強度(白丸)を示す。 $10\text{ cm}^{-1}$ 程度で解像度が細かい場合には、第2のピークのラマンシフト(黒丸)を正確に特定し易くなる。

10

#### 【0130】

なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。また光デバイス、検出装置、分析装置等の構成、動作も本実施形態で説明したものに限定に限定されず、種々の変形実施が可能である。

20

#### 【符号の説明】

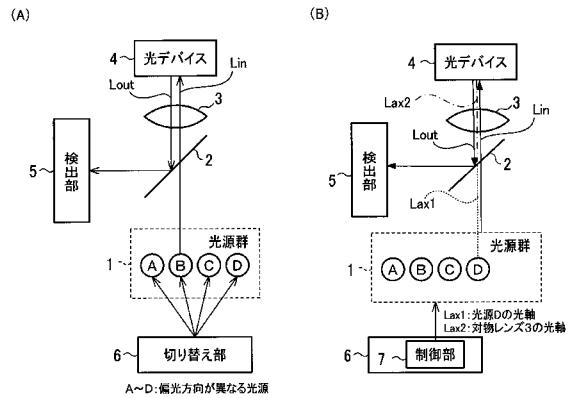
#### 【0131】

- 1 光源群(第1の光源群)、2 ハーフミラー、3 対物レンズ、4 光デバイス、  
5 検出器、6 切り替え部、7 制御部、8 第2の光源群、15 光源ドライバー、  
20 金属微粒子(金属ナノ粒子)、100 基板、101 レジスト、104 凹部、  
105 凸部、110, 210, 310 突起、115 突起群(第1の突起群)、  
120 表面、130 ガラス基板、140 金属薄膜、150 金属格子、  
205 第2の突起群、215 第3の突起群、220 頂面、230 底面、  
300 センサーチップ、320 コリメーターレンズ、330 偏光制御素子、  
360 集光レンズ、365 光フィルター、370 分光素子、  
375 分光ドライバー、380 受光素子、385 受光回路、  
400 吸入口(搬入口)、410 排出口、420 誘導部(搬送部)、  
421 吸引流路、422 センサーチップ付近の流路、423 排出流路、  
430 支持部、440 カバー、450 ファン、455 ファンドライバー、  
460 処理部、461 C P U、462 R A M、463 R O M、  
470 電力供給部、500 筐体、510 通信接続口、520 電源接続口、  
530 インターフェース、540 表示部、550 操作部、A~D 光源、  
B W 1, B W 2 共鳴ピーク波長帯域、D 1 第1の方向、D 2 第2の方向、  
D 3 第3の方向、D A ~ D D 偏光方向、L a x 1 光源の光軸、  
L a x 2 対物レンズの光軸(光学系の光軸)、L i n 光源からの光(入射光)、  
L o u t 光デバイスからの光(散乱光、反射光)、H 1 第1の高さ、  
H 2 第2の高さ、P 1 第1の周期、P 2 第2の周期、P 3 第3の周期、  
1 励起波長、2 ラマン散乱波長、p 1, p 2 共鳴ピーク波長、  
入射角度

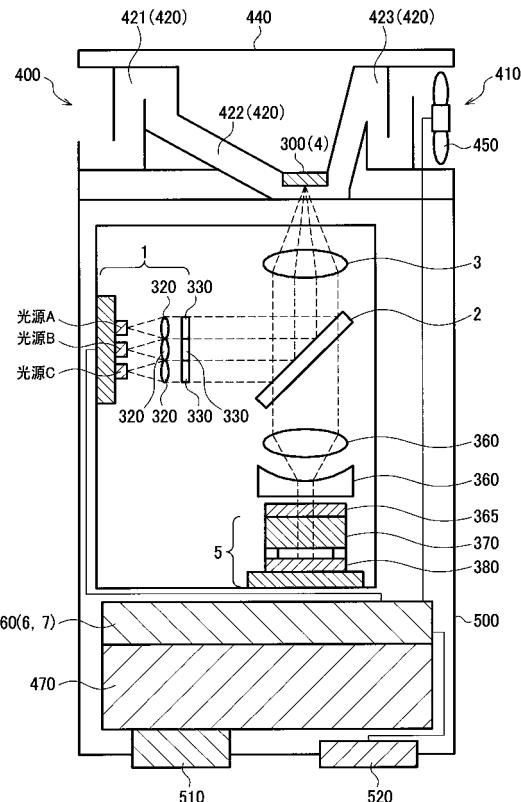
30

40

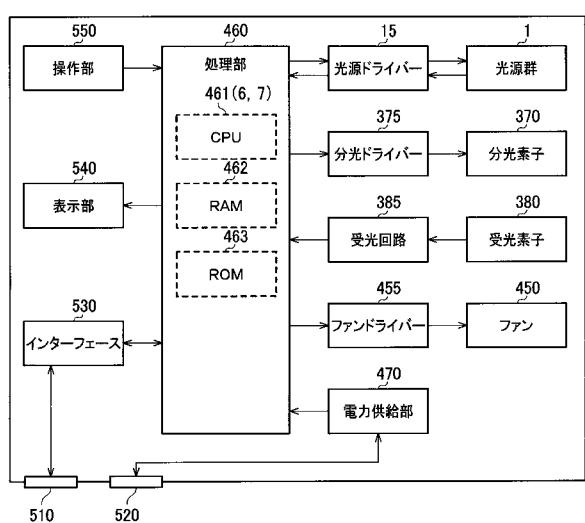
【図1】



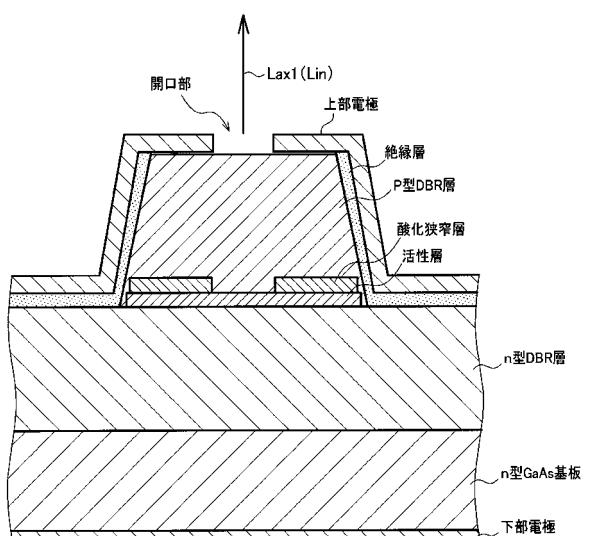
【図3】



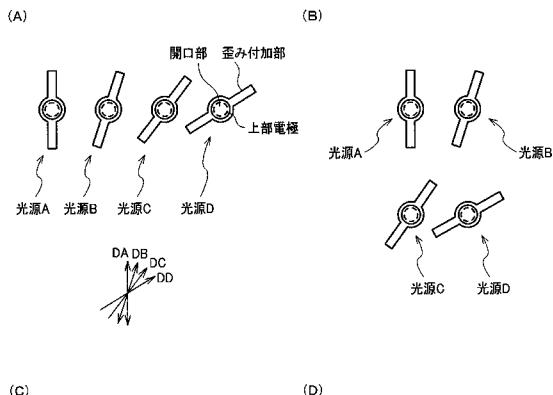
【図4】



【図5】



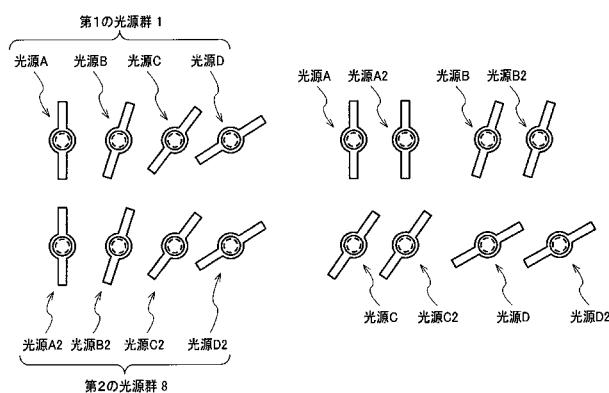
【図6】



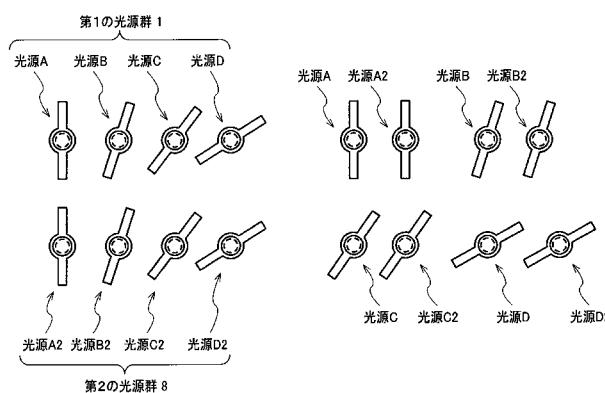
【図7】

	安定化 He-Neレーザー	DPSS (Nd:YAG レーザー)	安定化 半導体レーザー	VCSEL
波長	632nm	1064/532nm	785nm	785nm
継幅	○ 1GHz(~10pm)	○ 10kHz (~0.01fm)	△ 0.03nm	○ 30MHz (~50fm)
波長安定性	○ 1MHz	△ 0.2nm	○ 0.01nm/°C	○ 0.06nm/°C
発光	○ >20dB	○ >20dB	○ >20dB	○ 偏光面方向制御
消費電力 (~10mW 出力時)	× 数W	× 数W~数10W	△ 数100mW	○ 数10mW
体積	× 1,000cc	× 500~1,000cc	× 500~1,000cc	○ ~1cc

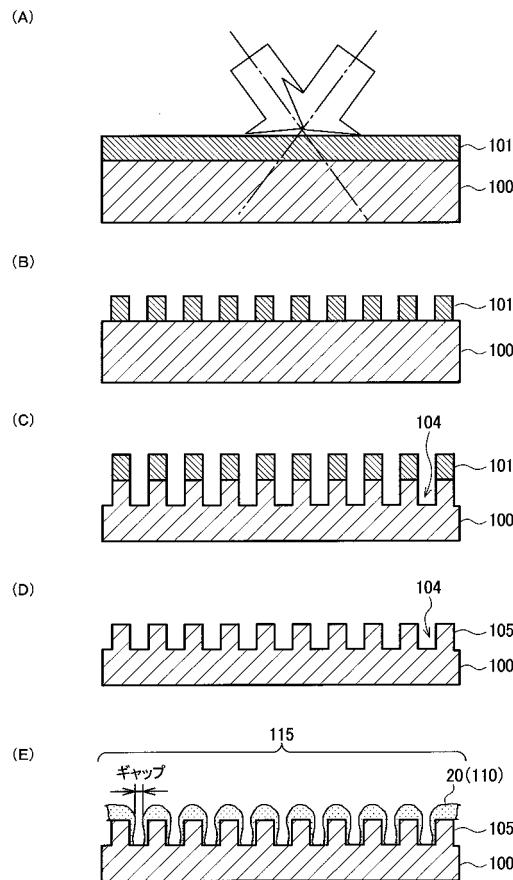
(C)



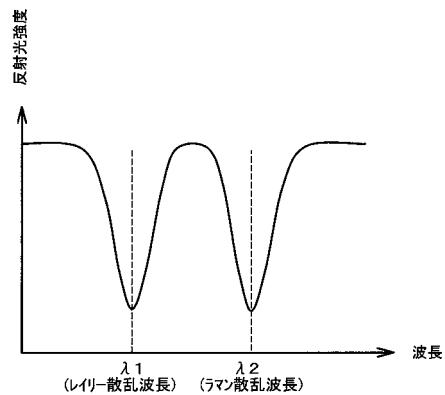
(D)



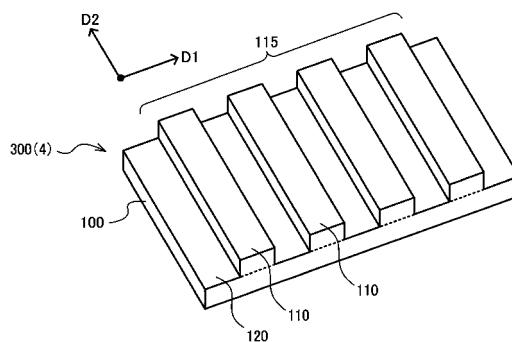
【図9】



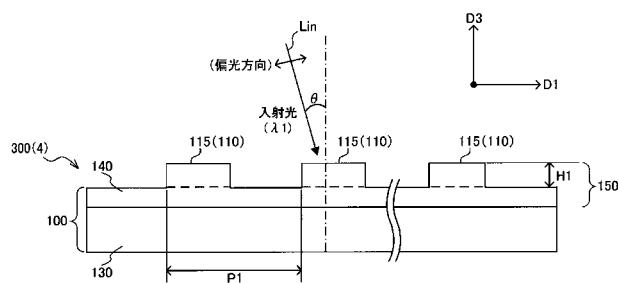
【図11】



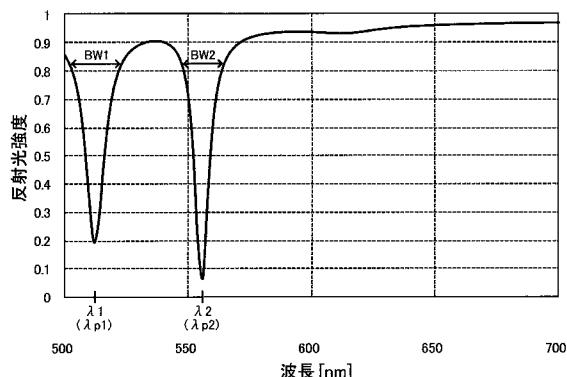
【図12】



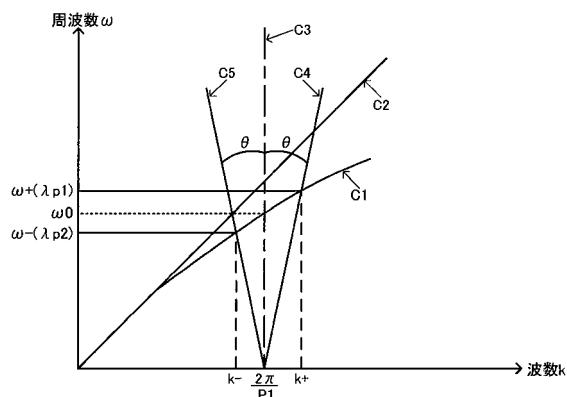
【図 1 3】



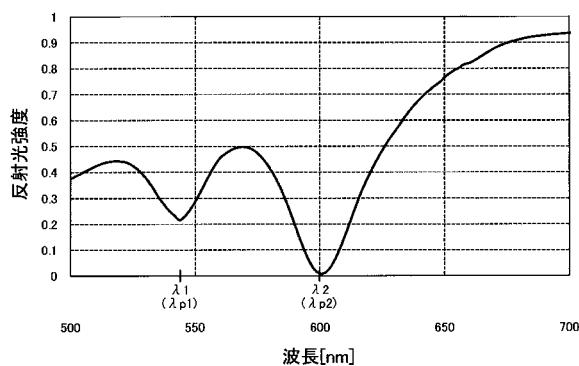
【図 1 4】



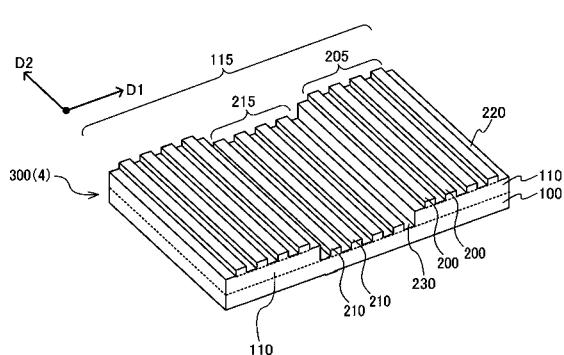
【図 1 5】



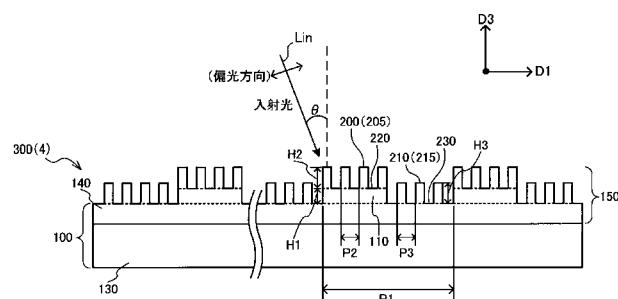
【図 1 6】



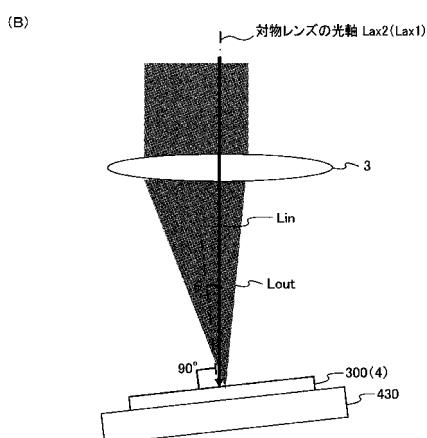
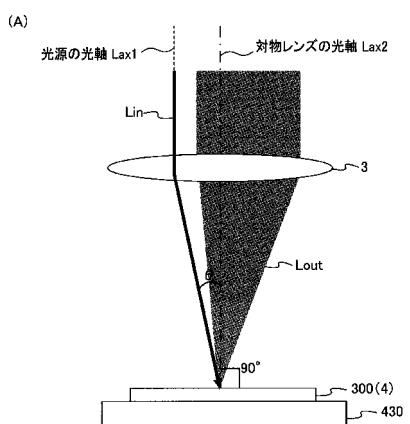
【図 1 7】



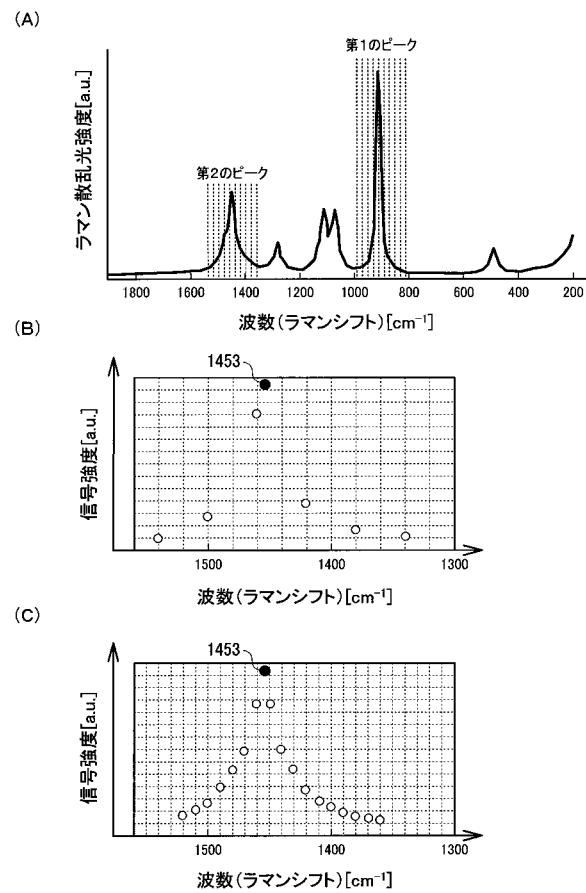
【図 1 8】



【図 1 9】

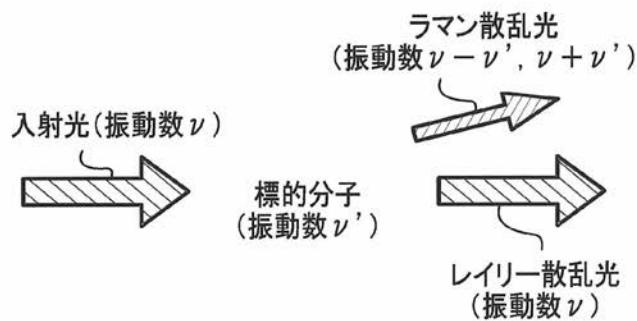


【図21】

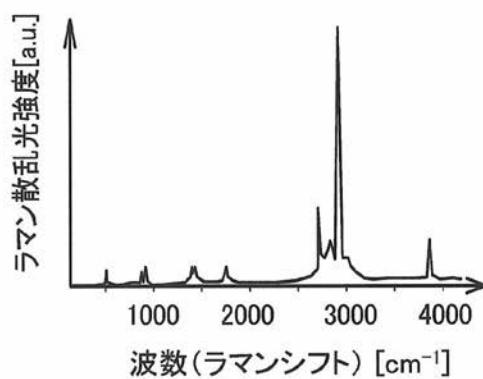


【図2】

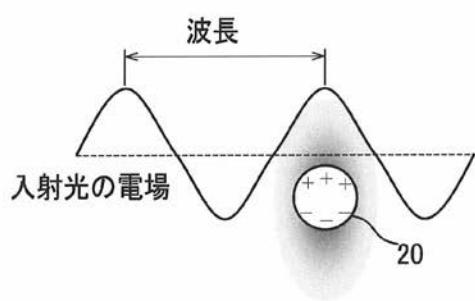
(A)



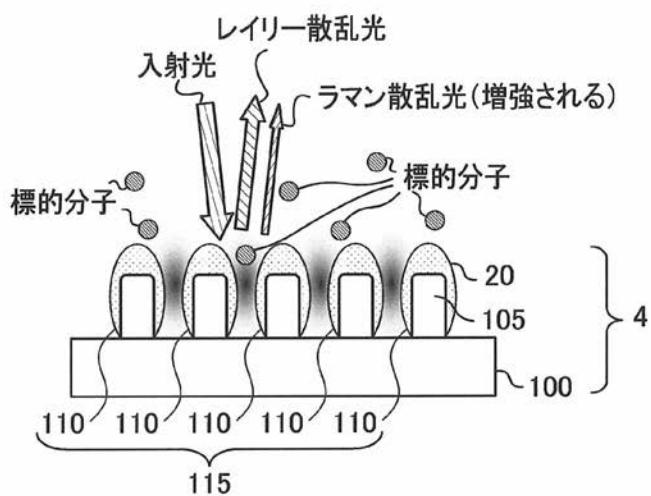
(B)



(C)

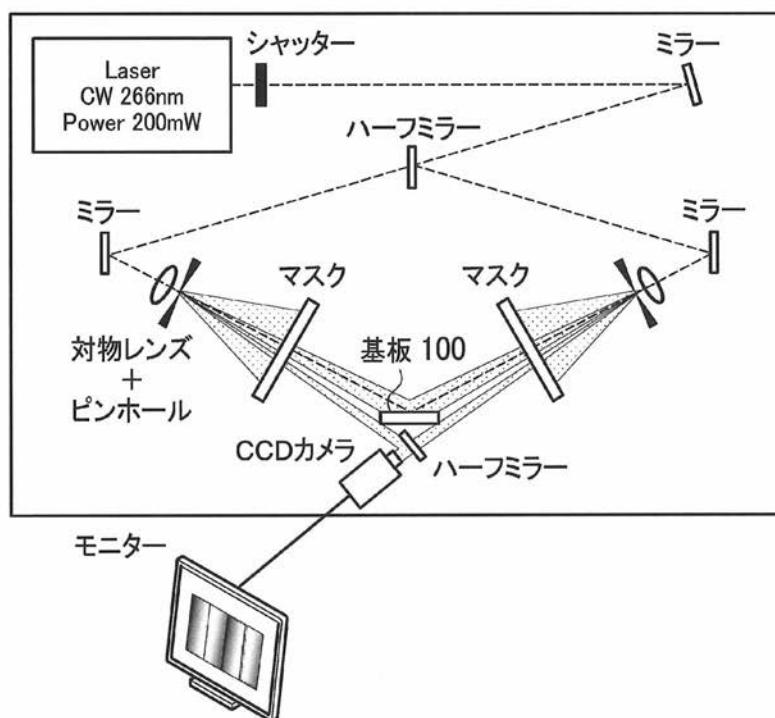


(D)

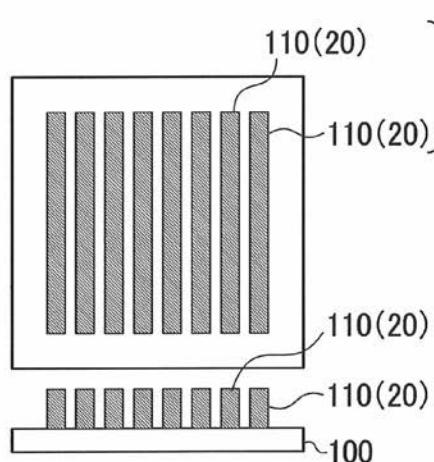


【図 8】

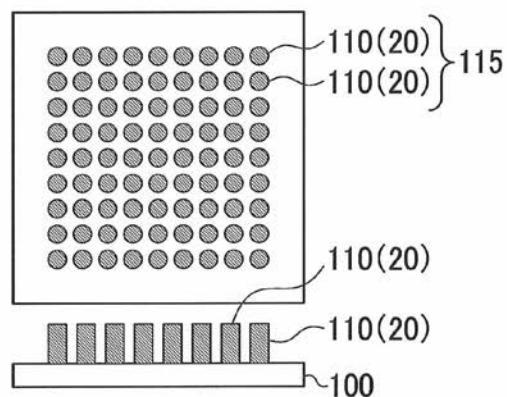
(A)



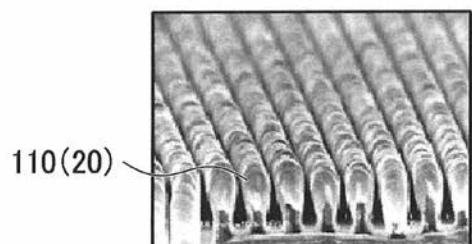
(B)



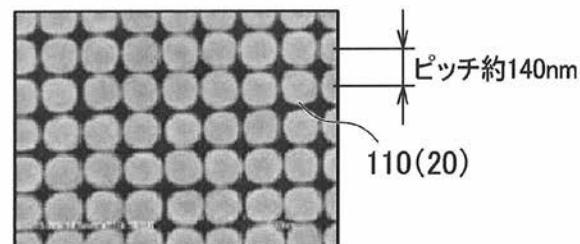
(C)



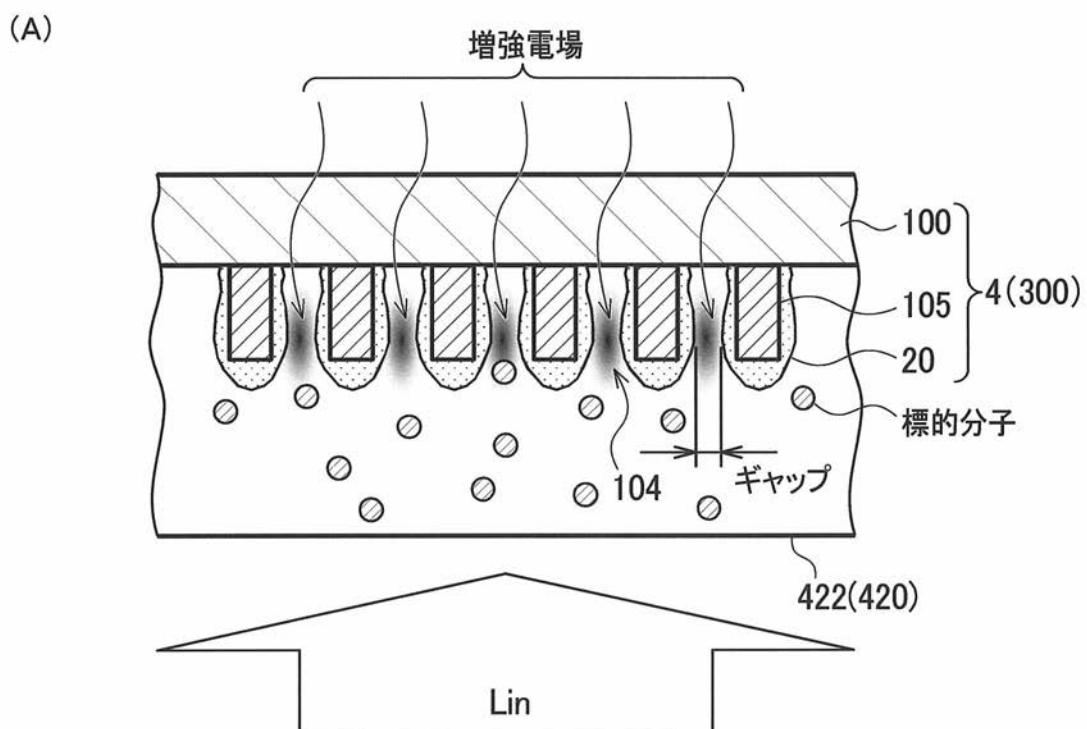
(D)



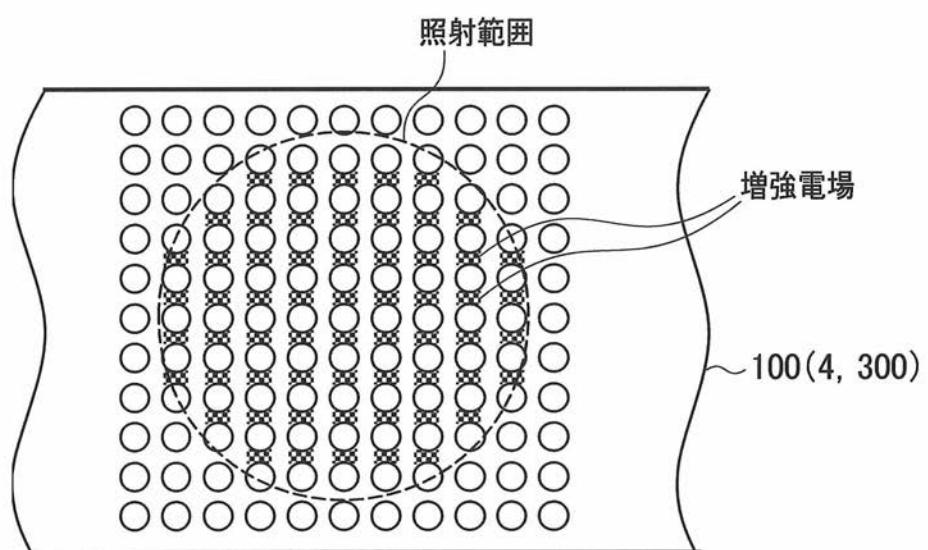
(E)



【図 10】

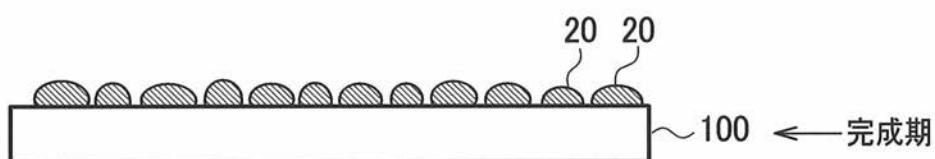
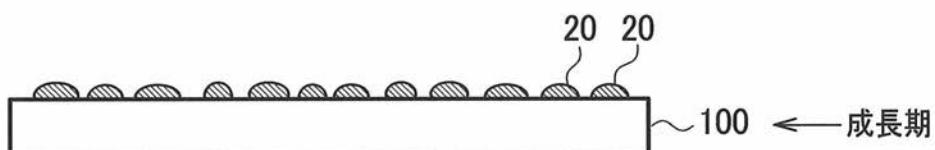
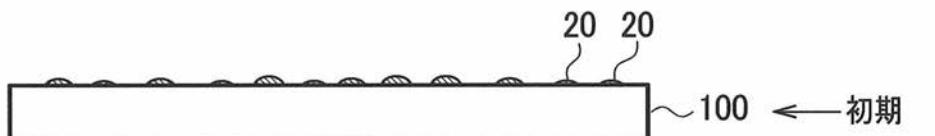


(B)

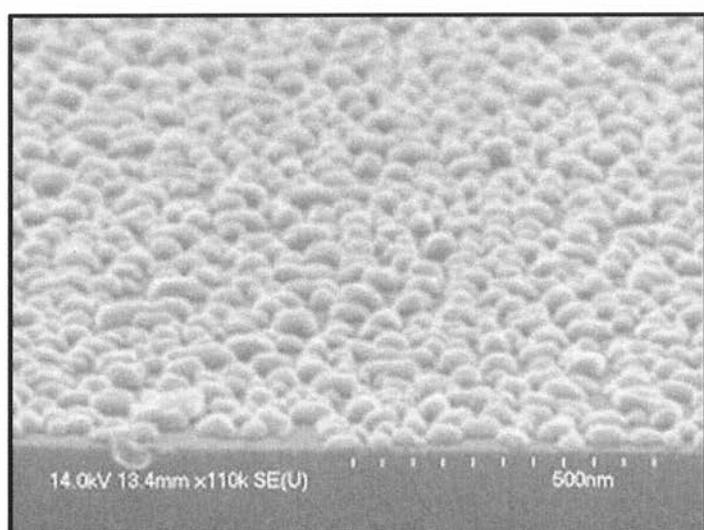


【図 20】

(A)



(B)



---

フロントページの続き

F ターム(参考) 2G043 AA03 BA14 BA17 CA01 DA05 EA03 GA06 GB07 GB28 HA01  
HA02 HA07 JA01 JA03 JA08 KA02 KA07 KA09 LA01 NA06